IICIE 国际集成电路创新博览会 INTERNATIONAL INTEGRATED CIRCUIT INNOVATION EXPO

elexcon 深圳国际电子展 暨嵌入式展

CIOE 中国光博会

IICIE
国际集成电路创新博览会
INTERNATIONAL INTEGRATED CIRCUIT INNOVATION EXPO

elexcon
深圳国际电子展暨嵌入式展
SHENZHEN INTERNATIONAL ELECTRONICS & EMBEDDED EXPO

2026年9月9-11日 深圳国际会展中心

SEPTEMBER 9-11, 2026 SHENZHEN WORLD EXHIBITION AND CONVENTION CENTER

智能汽车及机器人
产品采购指南

三展联动，打通半导体/光电/电子全产业链！

HALL 1-13 中国国际光电博览会　HALL14-16 IICIE 国际集成电路创新博览会/elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展

HALL 1

精密光学展&
摄像头技术及应用展

摄像头技术及应用馆

- 光学镜头
- 摄像模组

HALL 3

精密光学展&
摄像头技术及应用展

摄像头技术及应用馆

- 光学测量测试
- 光学注塑/模压非球面展区
- 蓝宝石加工应用展区
- 机器视觉及工业自动化

HALL 5

精密光学展&
摄像头技术及应用展

精密光学加工馆

- 超精微纳加工
- 光学元件
- 光学材料
- 光学加工设备

HALL 7

精密光学展&
摄像头技术及应用展

光学真空镀膜馆

- 光学镀膜材料
- 光学镀膜元件
- 光学镀膜设备区

HALL 9

信息通信展

光连接技术馆

- 光器件
- 光纤光缆/电线电缆
- FTTX新一代光纤网络
- 光纤熔接
- 数据中心

HALL 11

信息通信展

通信器件模块馆

- 芯片设计
- 化合物半导体/光芯片/元器件
- 组件/模块
- 卫星/空间通信
- 车载光通信

HALL 13

信息通信展

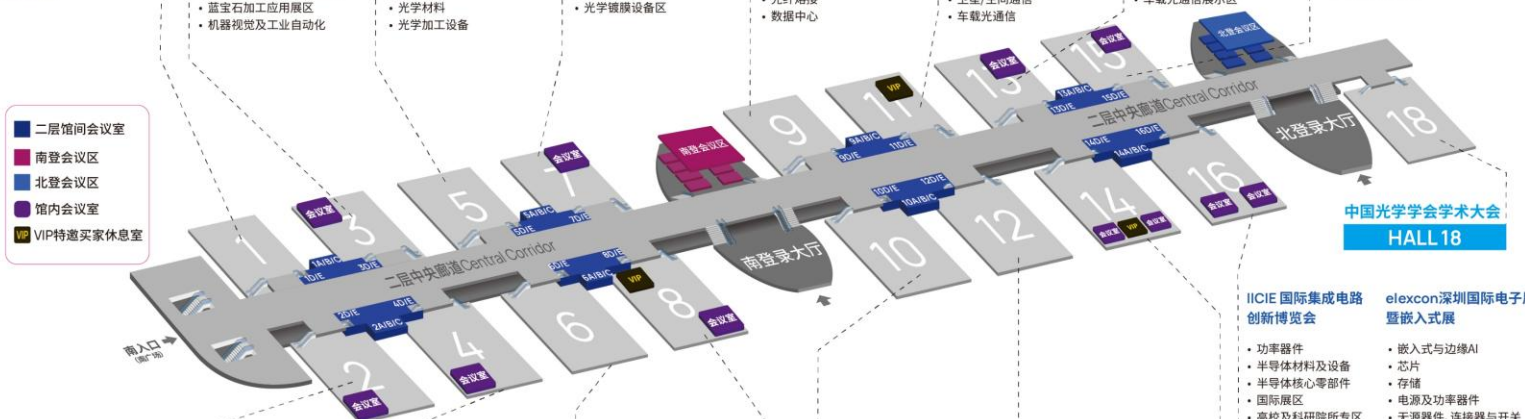
通信器件模块馆

- 芯片设计
- 化合物半导体/光芯片/元器件
- 组件/模块
- 车载光通信展示区

HALL 15

IICIE 国际集成电路创新博览会

- IC制造及代工
- 光刻专区
- 半导体材料
- 晶圆制造/设备
- 半导体核心零部件



中国光学学会学术大会

HALL 18

IICIE 国际集成电路创新博览会

- 功率器件
- 半导体材料及设备
- 半导体核心零部件
- 国际展区
- 高校及科研院所专区

elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展

- 嵌入式与边缘AI
- 芯片
- 存储
- 电源及功率器件
- 无源器件、连接器与开关

HALL 16

IICIE 国际集成电路创新博览会

- EDA工具/IP/芯片设计专区
- 先进封装
- 封装材料
- 半导体设备
- 半导体核心零部件
- AI应用特色展示区
- RISC-V 生态应用展示区

HALL 14

信息通信展

通信器件模块馆

- 芯片设计
- 化合物半导体/光芯片/元器件
- 组件/模块
- 信息传输设备
- 车载光通信

HALL 12

信息通信展

半导体及光通信

智能装备馆

- 测试测量/仪器仪表
- 封装设备
- 生产与制造设备

HALL 10

红外技术及应用展

- 红外热成像技术及应用
- 夜视仪及应用
- 成像仪器检测系统及设备
- 红外测温及材料
- 紫外技术及应用

HALL 8

智能传感展

光电子创新展

- 3D传感及成像
- 激光雷达&量子传感
- 工业传感器及测试检测系统
- 具身机器人展示区
- 科研院所及高校
- 专精特新及高新技术企业

HALL 6

激光技术及智能制造展

- 激光材料及元器件
- 激光组件及辅助系统
- 激光器
- 激光光谱及测试测量
- 激光医疗&美容展示区

HALL 4

激光技术及智能制造展

新型显示技术展

AR&VR展

- 激光设备/焊接展示区
- 智能装备及工业自动化
- Mini/Micro LED微显示
- 车载显示展示区
- AR/VR创新应用展区

HALL 2

CIOE 中国光博会 | IICIE 国际集成电路创新博览会 | 第23届 深圳国际电子展 暨嵌入式展 elexcon 2026

2026年9月9-11日
深圳国际会展中心（宝安）

CIOE中国光博会 X IC创新博览会 X ELEXCON深圳国际电子展 同期同地举办

构建光电-半导体-电子嵌入式一体化

三展联动，一证通览

本届三展联动，规模达到32万平方米，预计汇聚超5000家参展企业、吸引逾24万名专业观众，共同打造集技术展示、行业交流与商业合作为一体的国际化高端平台，为光电、集成电路、电子与嵌入式系统等关键领域注入强劲创新动力；

展会围绕AI算力、消费电子&AR/VR、智能汽车与具身机器人、半导体与智能制造等四大核心赛道，打通上下游技术、供应链与商业对接通道，加速跨产业融合创新，加速产业链融合与协同发展。

赋能汽车电子与具身机器人产业

智能汽车赛道：三展联动整合智能汽车全产业链资源。一站式集中展示车载光通信、多传感器融合解决方案、车载显示、汽车三电系统、整车连接线束等，五大技术板块完整覆盖智能汽车感知、高速传输、动力供给、整车布线、座舱交互全技术链路。

具身机器人赛道：三展联动呈现全套核心软硬件方案。依托视觉感知模块完成目标识别、人机交互与近距离环境探测；功率器件负责电能变换与伺服电机控制，直接决定机器人运动性能、续航能力与机身轻量化水平；连接器及线束同步承载动力供电与高速数据双通道传输；全栈芯片构建机器人 “决策大脑、运动小脑、感知神经”完整算力架构。

车规级芯片

扫码登记参观

深圳市中兴微电子技术有限公司 14A55

车规级高性能中央计算平台SoC芯片—“撼域”M1

M1 芯片是撼域系列第一颗面向新一代 E/E 架构的车规级高性能中央计算平台 SoC 芯片，具备大算力、高带宽、大存储、高安全的多域融合高速连接能力，可从容应对未来域集中架构的各种应用场景。



武汉新芯集成电路股份有限公司 15D42

新芯股份SPI NOR Flash芯片

新芯股份SPI NOR Flash芯片，采用浮栅型（Floating Gate）工艺结构，工作电压涵盖1.2~3.3V，支持低功耗宽电压工作，丰富且小巧的封装规格，助力计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、物联网等应用市场发展。



苏州国芯科技股份有限公司 14B50

高性能汽车电子AI MCU芯片CCRC4XXX

基于自主RISC-V 架构CRV6多核处理器设计的抗量子高性能车规AI MCU，采用 22nm RRAM 工艺，主频最高 500MHz，集成 0.3TOPS NPU 与硬件安全模组 HSM，支持抗量子与国密/国际算法硬加速。符合 AEC-Q100 车规与 ISO 26262 ASIL-D 最高功能安全等级，具备超高算力、抗量子安全、高可靠与高扩展性，可满足智能驾驶、中央域控、跨域融合、底盘 / 动力域等高安全与高算力需求。



深圳市安信达存储技术有限公司 14B62

嵌入式存储芯片

AXD SATAIII BGA SSD嵌入式存储芯片，具有SATA 6Gb / s接口速率并且向下兼容以及高度可靠的性能和耐用性。AXD SATAIII BGA SSD多DIE一体封装技术，可以实现极低的写入功耗，并延长SSD的寿命，同时提供极高的IOPS性能和具有高可靠性以及可以满足宽温级环境工作温度，可为嵌入式计算设备提供非易失性存储解决方案， 设计还包括擦除，写保护能特殊可选功能



宽禁带半导体及功率器件

扫码登记参观

比亚迪半导体股份有限公司 15D67

超级沟槽栅车规级IGBT芯片——IGBT8.0

全球领先超大功率密度车规级IGBT芯片，全新一代自主研发IGBT芯片，采用超精细沟槽技术，逼近物理加工极限，能效大幅提升。功率密度全球领先，定义电驱IGBT芯片效能和轻量化设计新标准： 超深亚微米沟槽栅； 超高电流密度； 优异开关特性，关断损耗达行业最优水平； 超大单芯设计，单芯片电流规格最高可达700A； 能效和续航全面提升； 超高功率密度：驱动功率提升30%，零百公里加速时间更短；



北京天科合达半导体股份有限公司 16B60

8英寸导电型碳化硅衬底

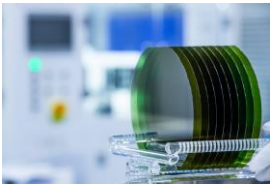
8 英寸碳化硅衬底因其有效利用面积与 6 英寸相比提高接近 90%，外延和晶圆制造成本增加不明显，且制程较 6 英寸更为先进等因素，可有效降低单个器件成本，在未来具有广阔的增长空间。天科合达目前已掌握高质量 8 英寸导电型碳化硅衬底制备的关键技术。目前取得的部分技术成果如下： 低微管密度控制技术； 低位错密度控制技术； 电阻率均匀性控制技术；



中电科半导体材料有限公司 16A58

N型SIC衬底

碳化硅具有高击穿场强、高热导率、高电子饱和速率、高抗辐射能力等优越性能，是固态光源和电力电子、微波射频器件的“核芯”，在半导体照明、新一代移动通信、智能电网、高速轨道交通、新能源汽车、消费类电子等领域有广泛的应用。产品包括：4~12英寸高纯半绝缘碳化硅衬底、4~12英寸N型碳化硅晶体及衬底。



广州南砂晶圆半导体技术有限公司 15D67

8 寸SiC产品

8寸导电型/半绝缘型产品，包含晶棒和衬底。



嵌入式

扫码登记参观

上海临滴科技有限公司 16C03 LPS3576 车控主机

LPS3576是基于瑞芯微RK3576芯片平台设计的一款车控主机，采用8nm工艺制程，具有低功耗和高算力的特点。集成了四核Cortex-A72和四核Cortex-A53 CPU，主频最高可达2.2GHz，并配备了6TOPS算力的NPU，支持多种深度学习框架和AI算法的高效运行。支持多种视频编解码能力，如4K@120fps的H.265解码、4K@60fps的H.264编码等，适用于车辆的AI应用场景。



研华科技 16A42 AOM-3841核心板

AOM-3841采用RTXe标准核心板：2.0mm抗失真PCB与B2B连接器，插拔力高达264N，抗震抗干扰性能优异，专为轨道交通、特种车辆等严苛场景设计。其扩展灵活：3x MIPI-CSI接口，支持DP/HDMI/MIPI-DSI多屏输出，满足复杂显示需求。



安勤计算机应用科技（上海）有限公司 16C03 板卡

安勤嵌入式主板涵盖X86与ARM两大平台
X86平台:支持COM Express/Qseven模块及兆芯国产CPU提供完整产品线。
ARM平台:覆盖 Rockchip/NXP/MTK/Qualcomm 全方案·提供工控机/平板/SBC/SMARC/OSM模块，兼具高效能、超低功耗与深度定制能力。



深圳市晟天维科技有限公司 16B06 车载智能显示终端(V7S)

坚固耐用的外壳设计，防护等级 IP65;
RK3568 处理器，2.0GHz;
4GB DDR+32GB eMMC;
7寸1024*600 ，支持高亮，支持多点触摸;
Android 14 操作系统;
内置 200 万像素 CMOS 前置摄像头，内置立体声扬声器;
内置 4G LTE、WiFi、蓝牙、GPS+北斗;
内置及扩展 I/O 接口：USB 3.0、SIM、TF卡槽;
丰富的I/O接口: RJ45、 RS232、RS485、倒车触发、CAN Bus、AV/AHD输入、ACC、倒车、GPIO等;



电子元器件

扫码登记参观

信维电子科技（益阳）有限公司 16A30 MLCC

MLCC是一种电子元件，属于被动贴片元件，主要用于稳定电压、滤除杂波，广泛应用于各种电子设备的电路板中，被誉为“电子工业的大米”。MLCC由多层陶瓷介质膜片和内电极交替叠合而成，通过错位堆叠、层压和高温烧结形成陶瓷芯片，再在两端封上金属端子（外电极），适合表面贴装。
MLCC应用领域很广泛，基本上有电信号的电子产品都需要用到，例如移动通信设备手机、电脑、可穿戴设备、AI服务器、4G/5G基站、各种电源、智能家电、医疗设备、数据中心等。



深圳市宇阳科技发展有限公司 16A45 MLCC

作为国内MLCC(片式多层陶瓷电容器)行业主要研发生产企业，宇阳科技自2001年成立以来，一直大力投资研发MLCC产品技术，率先在国内推出多款具有国际先进水平的MLCC产品，填补国内空白，推动和提升了国内MLCC技术和产业化水平，为国家基础电子工业发展做出重要贡献。



广东德鸿感应微电子有限公司 16D10 贴片电感

一体成型贴片电感采用铁粉芯一体压铸工艺，整体全屏蔽密闭结构，一体成型无缝设计，具备低磁漏、低阻抗、大电流、高饱和、耐高温、抗干扰、稳定性强等核心优势。产品体积小巧、贴片式安装，适配自动化SMT贴装，焊接性能优良，一致性高，不易磁饱和、不易发热，耐用性远超普通绕线电感。广泛应用于AI算力服务器、工控主板、新能源电源、车载电子、智能家居、通讯设备、LED电源、医疗设备、充电适配器、精密数码产品等各类高端电子电路。



创能电子(深圳)有限公司/创意电子 16A43 黑金刚铝电解电容

CHEMI-CON,简称NCC，国内一般称嘉美工或贵弥功，俗称黑金刚，是全球最大的铝电解电容生产商。产品在军载、新能源、通讯、工控、家电、医疗、PC、照明等市场均有广泛应用。



电子元器件

扫码登记参观

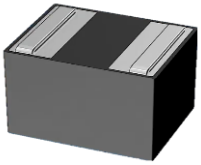
广东今凯电子科技有限公司 16C07 NR 系列磁胶功率电感

磁性胶水涂覆结构极大减少了蜂鸣声，直接在磁芯上金属化电极，抗跌落冲击强，经久耐用。闭合磁路结构设计，漏磁少，抗EMI能力强。同等尺寸，额定电流特性较传统电感高出30%以上。常用于DC/DC电路。



湖南华晟电通科技有限公司 16C46 转移注塑成型电感

转移注塑成型电感（又称无压成型电感），是采用类似半导体封测工艺的转移注塑成型技术，将线圈与 T-core 外层使用磁性塑封料直接无压一体化封装而成的新型电感器件。转移注塑成型电感是当前 AI 服务器、新能源汽车电子两大高景气赛道的主力配套产品，正迎来高速增长黄金期，已成为电感行业技术升级与国产替代的核心主力产品之一。



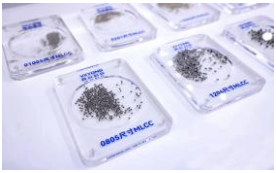
中山市汉仁电子有限公司 16C01 BMS变压器

确保电池组安全、高效通信的核心组件，设计满足高压隔离、抗干扰及严苛环境适应性等要求。



广东微容电子科技股份有限公司 14A60 MLCC

依托完整自研制造平台，公司在高容量、车规级、高频、超微型等高端 MLCC 领域实现全面技术突破：通用高容量产品容值最高可达220μF，并持续向更高容值迭代升级；超微型系列（008004/01005/0201）及射频系列产品已成为行业主流方案，出货量常年位居全球前三；车规级产品覆盖 0201 至 1210 全尺寸，具备高容量、高可靠、耐高温、高稳定性等优异特性。



存储产品

扫码登记参观

东芯半导体股份有限公司　16C50　SPI NAND Flash

单芯片设计的串行通信方案，引脚少、封装尺寸小，且在同一颗粒上集成了存储阵列和控制器，并带有内部ECC模块，使其在满足数据传输效率的同时，既节约了空间，又提升了稳定性。产品现拥有38nm及2xnm的成熟工艺制程，目前工艺制程已经推进至1xnm先进工艺制程。



深圳华芯星半导体有限公司　16B30　eMMC5.1

eMMC5.1分为商规级、工规级和车规级，在复杂多变的应用场合下，满足客户对eMMC大容量、高性能、低功耗、兼容性和稳定性的苛刻要求。
容量：4GB-256GB
协议：eMMC 5.1，向下兼容至3.1
读取速度：最高330MB/s
写入速度：最高240MB/s
尺寸(mm)：11.5x13x1.0



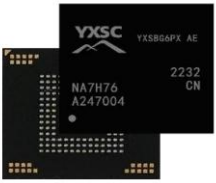
深圳市金胜电子科技有限公司　16D40　M.2 PCIe 4.0 固态硬盘

M.2 PCIe4.0 2280 固态硬盘，峰值读写速度达7400/6500MB/s，4K随机读写650000/670000 IOPS；支持宽温工况稳定运行，平均无故障时长200万小时，容量区间覆盖256GB~4TB，高耐久高可靠适配工业及算力类存储场景。



武汉喻芯半导体股份有限公司　16C70　喻芯国产eMMC

喻芯半导体eMMC5.1是行业主流存储芯片，高集成度国产晶圆及先进封装技术，SoC平台良好兼容性，支持工规宽温，商规(-25℃~85℃)，工规(-40℃~85℃)，顺序读取速度330MB/s，顺序写入速度240MB/s，封装尺寸BGA153 (11.5mm*13mm*0.9mm)，可广泛应用于网络通信，机顶盒，电视，消费电子，智能终端，物联网等领域。



存储产品

扫码登记参观

威刚电子（上海）贸易有限公司 14B66 14B66TRUSTA T7P5 Gen5 U.2 eSSD

TRUSTA T7P5 Gen5 eSSD 是我们的旗舰企业存储解决方案，旨在满足高端数据中心的严格需求，实现卓越的速度与行业领先的能效完美协同。T7P5基于NVMe 2.0c协议，配备PCIe Gen5 x4接口，采用先进的eTLC NAND技术，为关键任务负载提供卓越的服务质量（QoS）和可靠的24小时运行。



宇瞻电子（上海）有限公司 16B25 GraTherX DDR5 ECC CSODIMM 内存模组

随着 DDR5 内存广泛应用于 Edge AI、IPC、嵌入式系统等低风流、高热密度环境，内存容易产生热累积、背面热集中及散热不均等问题，进而影响系统长期运作的稳定性与可靠性。GraTherX DDR5 ECC CSODIMM 是专为解决上述散热挑战所打造的模块级散热解决方案。在无风扇自然对流测试环境下，GraTherX DDR5 ECC CSODIMM 可实现：模块最高温降低最高 20°C；模块正反面温差缩小至约 1°C 以内。通过更均匀的热分布，大幅提升内存散热效率，使 DRAM 平均故障间隔时间（MTBF）提升 2.7 倍，并将故障率（FIT）降低 60%，有效提升系统长期运作可靠性。



深圳豪杰创新电子有限公司 16A16 SSD-类工规存储系列

类工规存储系列SSD，采用原厂精选NAND，经过严格测试和强化筛选，具有更高的稳定性，产品涵盖如下：
M.2 NVMe PCIe Gen 3×4 SSD / M.2 SATA III SSD / 2.5" SATA III SSD
广泛应用于端侧AI、工控机、医疗设备、NAS存储等领域。



珠海博雅科技股份有限公司 16B04 NOR Flash，EEPROM

NOR Flash: 全系列，容量涵盖512Kb~2Gb，SPI和Parallel两种接口，高、低、宽压多种规格电压。极高性能，STR/DTR频率最高达 200MHz，擦写时间极短，支持Octal接口，最高读写速度高达3200MBit/s。极高可靠性，20年数据保存时间，10万次P/E Cycle，支持温度高达125℃，支持ECC, CRC，为客户带来极大保障。
EEPROM: 全系列，支持IIC和SPI两种接口，容量覆盖1Kb~2Mb。

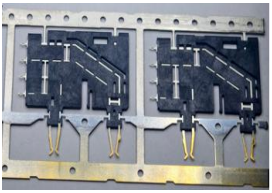


连接器

扫码登记参观

广东厚为电子有限公司 16B18 非标定制高速插拔类端子

非标定制高速插拔类端子针对通用标准端子无法适配的特殊工况，按需定制的高性能连接部件，专为高频次插拔场景打造，可完全匹配设备专属的空间布局、性能参数与装配需求。这类定制端子可灵活调整针径、孔径、开槽结构、焊接端头形态，支持不同镀层厚度、特殊材质选型，适配航空插头、工业防水接头、精密传感接插件等非标准装配场景。产品从模具设计、打样确认到批量生产全链路自主完成，适配汽车电子、通讯、医疗精密仪器等领域的特殊连接需求，提供专属的高可靠连接解决方案。



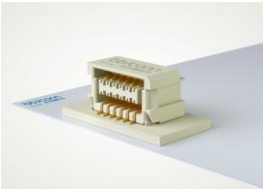
深圳市硕凌电子科技有限公司 16B17 板对板连接器

板对板（BTB）连接器用于连接印刷电路板（PCB），这些电子元件以准确和可重复的方式在绝缘基座的表面印有导电图案。BTB连接器上的每个端子都与PCB相连。一个BTB连接器包括外壳和特定数量的端子。端子由导电材料（主要是铜合金）制成，并进行电镀以提高导电性和防锈。端子在通过BTB连接的PCB之间传输电流/信号；外壳由绝缘材料（主要是塑料）制成。



深圳市步步精科技有限公司 16B70 针座连接器

Wafer作为步步精的主力产品线，在深圳园区制造，品质可靠、品类齐全，广泛应用于消费电子、汽车电子及工业控制等领域。凭借稳定性能和优质工艺，步步精Wafer连接器正逐步实现国产替代进口，成为客户值得信赖的核心选择。



深圳市步步精科技有限公司 16B70 DP连接器

DP连接器（DisplayPort连接器）是一种高速数字视频接口，广泛用于电脑、显示器和显卡之间的音视频传输，支持4K/8K超高清分辨率和高刷新率显示，并兼容HDMI、DVI等接口。近年来，步步精公司已成功实现DP连接器的快速量产，产品在信号稳定性和工艺精度上表现突出，广泛应用于高端显示设备及工业领域。



*以上所有企业展位号及产品内容以现场为准。

CIOE 中国光博会 | IICIE 国际集成电路创新博览会 INTERNATIONAL INTEGRATED CIRCUIT INNOVATION EXPO | elexcon 深圳国际电子展 暨嵌入式展



产品采购指南

智能汽车及机器人

三展联动，打通半导体/光电/电子全产业链

第27届中国国际光电博览会

2026年9月9-11日　深圳国际会展中心

即刻扫码免费参观

CIOE中国光博会——车载方面：覆盖**汽车光通信、汽车感知、车载显示**等三大板块，集中展示**光芯片、模块、车规光纤线束、车载摄像头、车载红外夜视、3D视觉感知、激光雷达、智能座舱显示、Mini/Micro LED**等；

扫码登记参观

部分展示企业如：

- ✓ **车载摄像头：**舜宇光学、联合光电、宇瞳光学、凤凰光学、AAC Optics、特莱斯、福特科光电、中光学、海创光电；
- ✓ **3D视觉：**艾迈斯欧司朗、芯视界、睿熙科技、瑞识科技、志强视觉、美芯晟科技、芯探科技、思岚科技、向至科技、力策科技、国微感知、蓝海光电、启激科技；
- ✓ **红外夜视：**高德红外、睿创微纳、大立科技、富吉瑞、夜视院集团、海康微影、华感科技、中星时代、焜腾红外、华国光学、深知未来、光智科技；
- ✓ **车载显示：**水晶光电、赛富乐斯、芯视元、思坦科技、立珑半导体、镭昱光电、视涯、昀光科技、西湖烟山科技、芯视佳、宏禧科技、诺视科技；
- ✓ **芯片及模块：**COHERENT高意、鹏瞰半导体、光莆、光迅、芯思杰、度亘、大普技术、三菱、三安光电、长光华芯、奇芯、光特、中电十三所、赛勒、国科光芯、三优、帝奥微、优迅股份、米硅、芯升半导体、苏纳、广州光为、亿芯源、申和、鸿星科技、彼格、圣达、杭州先导；
- ✓ **车载网络：**长飞、烽火、科谱、华工正源、CORNING、欧亿光电、乐庭智联、永鼎、华晟福涛；

IICIE国际集成电路创新博览会——汇聚芯片及芯片设计厂商，涵盖MCU、SoC、运动控制芯片、安全加密芯片，配套车规晶圆制造、高可靠封装；还将设置AI+汽车电子应用特色展区，汇聚芯片、方案等企业；

部分展示企业如：中兴微电子、华润微电子、比亚迪半导体、爱特微、北京君正、澜起科技、紫光国微、广立微、复旦微电子、灿芯半导体、谱瑞集成、极海半导体、成都华微电子、国芯科技、算能科技、京微齐力、鸿芯微纳、珠海芯动力、进迭时空、隼瞻科技、六岳微电子、二进制半导体、乘翎微电子、达摩院玄铁、美创希、清芯智研、中德工业、华沅微、思凯迈、珈港科技、妙存科技、 一微科技、智现未来、泰芯半导体、象帝先、智芯科、澜昆微、Advinno等。

elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展——覆盖车规与机器人硬件配套：车规被动元器件、车载电源管理、伺服驱动功率器件、机器人嵌入式运动控制主板、工业级高速连接器、宽温存储模组、边缘实时控制系统，提供整车电控、机器人整机集成硬件方案。

部分展示企业如：研华科技、长江存储、SEGGER 中国（哲戈微）、航顺、灵动微、上海贝岭、朗科、东芯、德明利、宇瞻、信维电子、微容、京泉华、宇阳、厚声、立功科技、安勤科技、九芯、模量科技等；

扫码登记参观

三展联动相关会议：

时间	会议名称	会议地点	展馆号
09/09 下午	2026第五届车载摄像头前沿技术与测试方法研讨会	1号馆二楼1B	1号馆
09/09下午	RISC-V产业生态创新大会	14号馆二楼14C会议室	14号馆
09/09 -/09/10	第八届中国嵌入式技术大会	16号馆会议室1	16号馆
09/09 全天	新能源汽车电子创新技术论坛	18号馆1CC105B	18号馆
09/10 全天	第八届“光"+智能汽车技术高峰论坛	5号馆二楼5C	5号馆
09/10 全天	第41届“微言大义”研讨会:3D传感与成像技术及应用	6号馆二楼6B	6号馆
09/10 全天	2026车载光通信技术创新应用论坛	9号馆二楼9A	9号馆
09/10	汽车芯片产业创新论坛	14号馆二楼14B会议室	14号馆

特色展示区及馆号：

***会议名称以现场为准**

- ✓ 车载显示展示区——2号馆；
- ✓ 车载光通信实景体验区——13号馆；
- ✓ 汽车芯片展示区——14号馆；
- ✓ AI+汽车电子应用展区——14号馆；

具身机器人赛道

三展同步联动呈现全套核心软硬件方案：依托视觉感知模块完成目标识别、人机交互与近距离环境探测；功率器件负责电能变换与伺服电机控制，直接决定机器人运动性能、续航能力与机身轻量化水平；连接器及线束同步承载动力供电与高速数据双通道传输；全栈芯片构建机器人 “决策大脑、运动小脑、感知神经” 完整算力架构。

特色展示区：

- ✓ **特设“具身机器人展示区”**，位于CIOE中国光博会6号馆，部分参与企业如智身科技、遨博智能、瑞松机器人、蓝海光电、格科微、华域汽车等；

三展联动相关会议：

***会议名称以现场为准**

时间	会议名称	会议地点	展馆号
09/09下午	2026具身智能产业大会 --从算力到执行，构建具身智能系统	15号馆馆内会议室	15号馆
09/09 -/09/10	第八届中国嵌入式技术大会	16号馆会议室1	16号馆
09/10 上午	面向具身智能的智能光学技术论坛	1号馆二楼1A	1号馆
09/10 全天	视觉感知·智造未来 - 具身智能机器人融合应用论坛	6号馆二楼6A	6号馆

产品类别目录

扫码登记参观

产品类型	同期展会	页码
核心技术·具身智能&激光雷达		
具身智能机器人	智能传感展/红外展/精密光学展	9
激光雷达产品	智能传感展/信息通信展	10-13
激光雷达芯片	智能传感展/精密光学展/信息通信展/新型显示展	14-16
激光雷达核心器件	智能传感展/信息通信展	17
激光雷达光学元件	精密光学展	18
核心技术·摄像头模组		
镜头模组	智能传感展/激光及智能制造展	19-20
光学镜头	精密光学展	21
光学镜片	精密光学展/智能传感展	22
光学元件	精密光学展/光电子创新展/新型显示展	23-24
光学材料	精密光学展	25
核心技术·视觉及显示		
HUD	新型显示展/红外展/智能传感展	26-27
新型显示技术	新型显示展/红外展/智能传感展	28-29
视觉传感器	精密光学展/智能传感展	30-32
图像传感器	精密光学展/智能传感展	33
MEMS传感器	激光及智能制造展/新型显示展	34
光源	智能传感展/精密光学展/信息通信展/新型显示展	35
红外技术	红外技术展	36-37

产品类别目录

扫码登记参观

核心技术·车载光通信		
车载光通信	信息通信展	38
车用芯片	信息通信展	39
车载器件/模块	信息通信展	40
测试测量及检测		
检测仪/检测设备	精密光学展/智能传感展	42
重点展示生产制造设备		
智能装备	激光及智能制造展/光电子创新展/精密光学展	44
同期展会：IICIE/深圳电子展		
汽车芯片	IICIE国际集成电路创新博览会	46
宽禁带半导体及功率器件	IICIE国际集成电路创新博览会	47
芯片	深圳电子展	48
嵌入式	深圳电子展	49
电子元器件	深圳电子展	50-51
存储产品	深圳电子展	52-53
连接器	深圳电子展	54



重点技术展示

展示范围：

具身智能：具身机器人；

激光雷达：激光雷达产品、激光雷达芯片、激光雷达核心器件、激光雷达光学元件；

摄像头：镜头模组、光学镜头、光学镜片、光学元件、 光学材料；

视觉及显示：HUD、新型显示技术、视觉传感器、图像传感器、MEMS传感器、光源、红外技术；

车载光通信：车载光通信、车用芯片、车载器件/模块；



具身机器人

扫码登记参观

激光雷达产品

国奥科技(深圳)有限公司 10C72 专业级工业具身机器人

国奥科技G-Tools专业级工业具身机器人实现核心技术突破，全面重构底层机械结构，采用国奥自研“二自由度直线旋转电机”，创新集成双自由度关节，可同步完成直线与旋转复合运动，省去冗余中间传动环节。从物理根源上杜绝误差累积，实现精度跨量级提升，重复定位精度达±2 μm，远超行业主流亚毫米级（≥20 μm）设备水平。



广东灵锶智能科技有限公司 1C21 灵锶 D30是中型全地形四足机器人

灵锶 D30是中型全地形四足机器人平台，主打轻量级工业场景的 性能均衡与高性价比，适用于电力巡检、石化探测、应急搜救、科研教学等领域。核心包括： -紧凑灵活 ：整机重量仅 36kg，站立宽度 410mm，可轻松穿行狭窄通道、管道等受限空间；冲刺速度达 5m/s，能攀爬 45° 斜坡与 30cm 单台阶。 -可靠负载 ：持续负载 30kg，瞬时站立负载 100kg，可搭载双光热成像仪、气体检测模块等全套巡检设备；936Wh 电池支持 2.5 小时负载续航与快速换电。工业级防护 ：IP56。



立讯精密科技（南京）有限公司 2A105 陪伴投影机器人

家庭老人、小孩陪伴和娱乐 自动巡航、实时监控 高清投影和3D音效



吉林省智为光电技术有限公司 6C86-2 伴随式机械狗

伴随式机械狗是集成穿戴式随动控制系统的全地形四足无人装备。佩戴易控手环后，用户通过手势即可实时操控其前进、转向、跨越等仿生动作，实现人机协同。主要为宇树GO2四类产品，站立尺寸70×31×40cm，重约15kg，载荷8kg（极限12kg），配15000mAh电池，续航2~4小时，速度0~3.7m/s（极限5m/s）。适用于安防巡逻、野外侦查、应急救援及高校科研，以手势交互拓展伴随式机械狗的应用场景。



激光雷达产品

扫码登记参观

舜宇车载光学 1B61 短距激光雷达

180°×135° 超广视角 覆盖大范围盲区 0.1m 超近盲区， 近距离高精度感知、精准探测 8cm² 超小外露， 高集成度，适配隐藏式设计



深圳市机智人科技有限公司 6A10 144线面阵激光雷达

测距型激光雷达，雷达数据精度和数据频率较高。.最新长距雷达产品可以做到70米检测范围,0.625角分辨率，每秒最高270000点云密度输出。通过IP67，通过各种变化各种严苛测试。操作界面简单，产品使用方便易操作，近距离数据清晰可靠，边界清晰，雷达数据稳定，无明显噪声。



香港应用科技研究院 3D34 高速线扫激光雷达

一款 2D 线扫描激光雷达，采用创新性的阈值采样波形数字化技术，可生成高精度点云数据。该设备具备卓越的扫描性能：线扫描频率达 500-1000 次 / 秒，点云生成速率高达 200 万点 / 秒。搭载于汽车、列车等移动检测平台时，即便在 80km/h 时速下，仍能保持≤5cm 的点云分辨率，可实现隧道、铁路等交通基础设施的高密度、高精度三维重构，为交通设施智能化巡检提供创新高效的技术方案。



深圳国微感知技术有限公司 6B27、6B28 固态激光雷达AS01

采用了最新研发的混合堆叠集成式单光子雪崩二极管（SPAD）技术，VCSEL 激光器， 运用dToF 测距原理，输出 3D 图像，可用于无人机定高和找平，辅助聚焦，安防监控、导航避障等场景。



激光雷达产品

扫码登记参观

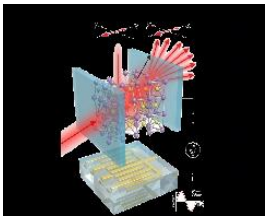
深圳力策科技有限公司 6B25、6B26 工业级激光雷达

LT-I1是工业激光雷达，70%反射率目标最大探测距离可达70米，90KHz采样率和10~30Hz扫描频率，提供了更高的角度分辨率（0.039°~0.117°）。



阜时科技有限公司 6B45 全固态激光雷达的光扫描模块产品

光扫描模块专为车载自动驾驶、RoboTaxi等市场的长距全固态激光雷达研发的一种全固态激光扫描技术，无任何运动部件，可以让激光束实现大角度的偏转。此产品与阜时科技的面阵SPAD-SoC芯片配合，可实现超过200m长距离全固态激光雷达模组产品。



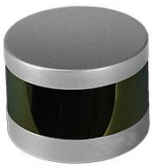
深圳国微感知技术有限公司 6B27、6B28 单线激光雷达

01A系列单线扫描激光雷达，是国微感知推出的2D单线激光雷达。它基于DTOF（直接飞行）测距原理，通过旋转扫描实现二维区域探测，其点云采样频率高达60,000点/秒，可精准感知细腻的周围环境。01A系列单线扫描激光雷达具备测量精度高、测量距离远、体积小便于集成等优势，已成为服务机器人不可或缺的核心组成部分，为服务机器人实时定位导航、智能避障、自主行走等功能实现提供有力保障。



东莞奈那卡斯精密压铸有限公司 8C64 无人驾驶激光雷达传感器

镁合金压铸，产品更轻且LT更短。



激光雷达产品

扫码登记参观

芯探（上海）科技有限公司 6B18 XT-S240激光雷达

XT-S240是一款高性价比、安全可靠的纯固态激光雷达传感器。产品没有任何运动机械部件，持久耐用不易损耗。可广泛应用于包括体积测量、室内/室外服务机器人、门禁安防等众多领域，例如：AGV、AMR、配餐机器人、割草机等应用。



郑州西曼传感技术有限公司 6E08 OW1 3D 360°激光雷达

测距能力：0.1~70m(40m@10%) 线数：48线 测距精度：2cm(1σ) 水平视场角：360° 垂直视场角：50°(-5°~ +45°) 扫描速率：10Hz 通讯接口：百兆以太网 100BASE-TX



华域汽车系统股份有限公司 6D61-2 X2_S78_激光雷达

本产品为2D扫描全固态广角激光雷达，具备150°超大视场角和最大70m的测距能力，功耗低，精准度极佳。 S78 产品特点： 小体积，镜头外露尺寸仅25mm*40mm 大视场，FOV为150°*100° 高性能，测远＞70m(25m@10%) 高集成度，内置IMU 高性价比，千元级产品 高可靠性，车规级产品 高兼容度，插件可定制化服务



杭州万隆通讯技术有限公司 12C26 车载半固态激光雷达

车载半固态激光雷达含 360°、90°FMCW 两款型号，面向自动驾驶、智能交通提供高精度可靠感知。采用 1550nm 连续波激光，安全性高；FMCW 技术规避阳光、多机干扰，探测灵敏。可输出目标瞬时速度，降低 GPU、SLAM 算力消耗，无高精地图也能稳定运行城市 NOA，精准识别抛洒物、行人；远距离点云识别能力强，探测更远、响应更快，保障智能驾驶安全落地。



激光雷达产品

扫码登记参观

金华市蓝海光电技术有限公司 6D61-1

激光雷达LDS-M200-E

LDS-M200-E非重复式扫描多线激光雷达360°×90° 超广视场角 ；50m测距能力 ；内置 IMU 。全维度感知，无死角防护：90° 垂直视场角大幅提升对低矮障碍物与高处悬挂物的识别，助力 AMR 实现真正的全向建图



深圳市威睿晶科电子有限公司 8E66

激光雷达

深圳市威睿晶科电子有限公司在激光雷达领域拥有多项技术专利和丰富的研发经验。公司专注于激光测距模块及相关应用产品的研发、生产和销售，致力于为用户提供高质量、高性能的激光雷达产品。



长春理工大学 6C86

测风激光雷达

机舱测风激光雷达WIND-JC系列是珩辉测量针对风电客户智能化应用方案，自主研制的机舱式测风激光雷达，是一种安装在风力发电机组机舱顶端的激光遥感测风装置。雷达采用相干探测体制，基于激光多普勒频移的原理，能够实现对风机叶轮前方 50m-200m/400m/500m/750m 风矢量场的精确测量。



芯探（上海）科技有限公司 6B18

XT-M60 PRO 激光雷达

XT-M60Pro 是一款高性价比、安全可靠的纯固态 Flash 补盲激光雷达传感器。产品无任何运动机械部件，持久耐用、损耗更低，等效 60 线成像，100kLux 强光下稳定出图，IP65 防尘防水，支持 9-36V 宽压供电，通过车规级可靠性验证，体积小巧易集成，支持批量量产。可广泛应用于低速无人车、工程机械、巡检无人机、户外安防机器人、车载补盲等众多领域，例如园区配送车、工程作业车、巡检无人机、厂区安防机器人等场景。

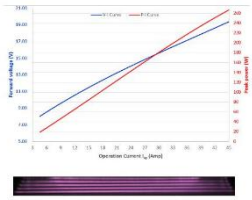


激光雷达芯片

扫码登记参观

深圳瑞波光电子有限公司 4A085 激光雷达用905nm EEL芯片

基于激光雷达市场的蓬勃发展，瑞波光电为该应用领域开发了多款低温漂905nm EEL芯片系列，包括65W/135W/165W单管芯片，以及1*8和1*16阵列芯片，同时在展会上首发国内首款可商业化的5节功率225W芯片，支持常规温漂（0.28nm/k）和低温漂(0.06nm/k)，所有芯片均支持TO和SF封装；客户通过使用瑞波迭代的新款905nm EEL芯片，可以开发出性能更优、成本更低的新一代激光雷达。



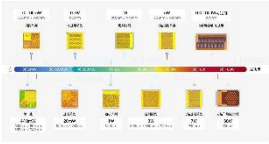
深圳市柠檬光子科技有限公司 6C05、6C06 850nm高偏振VCSEL激光芯片

850nm偏振VCSEL激光芯片是柠檬光子专为高端传感与探测应用设计。该产品具备优异的偏振稳定特性，有效提升系统信噪比与探测精度。其光束质量高，呈对称高斯分布，发散角小，能量集中。这简化了光学系统设计，减少外部元件，降低成本并确保信号可靠。适用于3D传感、激光雷达、工业检测及消费电子等领域。 峰值光功率高达10W， 电光转换效率~43%， 远场发散角19° 消光比~15dB 光谱宽度（FWHM）1nm。



深圳瑞识智能科技有限公司 6B39 VCSEL光芯片

瑞识VCSEL芯片产品矩阵种类齐全，涵盖了单孔或多孔芯片，规则或随机发光孔阵列芯片，单结或多结芯片，可寻址芯片。光功率从毫瓦级低光功率（连续驱动）至数百瓦级的超高光功率（脉冲驱动），波长范围包含红光可见光（650nm-680nm）和近红外光（808nm、850nm、905nm、940nm）。 瑞识VCSEL芯片产品可广泛应用于诸如接近传感、3D ToF/结构光、激光雷达、人脸识别、机器视觉、安防监控、医疗美容等应用领域，并可根据客户特定需求快速定制开发芯片。



常州纵慧芯光半导体科技有限公司 13A82 4x100G VCSEL

4x100G PAM4 VCSEL

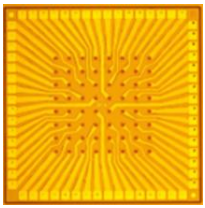


激光雷达芯片

扫码登记参观

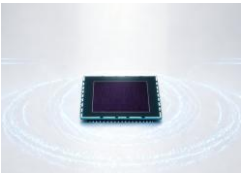
深圳博升光电科技有限公司 13C82 多节VCSEL激光雷达芯片

激光雷达高功率多结VCSEL； 动态可寻址VCSEL阵列。



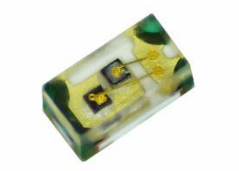
杭州灵明光子科技有限公司 6C52 ADS6321

车规级芯片，采用 320 × 240 高分辨率纯固态 SPAD 架构，SPAD 间距缩小为8 μm，在更紧凑的芯片架构中实现了更高的深度分辨率。就目前公开可见的车载纯固态面阵SPAD方案而言，320 × 240的深度分辨率处于同类产品的前列。更进一步看，ADS6321凭借更小的 8 μm SPAD pitch 和更高的原生像元密度，在相同视场（FoV）下能够提供比上一代更细的角分辨率，对目标轮廓和空间边界形成更细致的刻画能力。



江苏雷霆光电科技有限公司 6D141、6D142 0402 VCSEL

Size(L*W*H mm) ： 1.0*0.5*0.5 λd(nm) ： Typ.940 Radiant Intensity(mw/sr) ： Typ.36 VF(v) ： 1.8~2.3 Viewing Angle(°) ： 16~25° IF(mA) ： 15



浙江睿熙科技有限公司 6C41 车载VCSEL芯片及多结VCSEL芯片

睿熙科技车载产品涵盖智能座舱和智能驾驶完整产品布局。 睿熙科技多PN结的VCSEL激光器，优点是发光效率比较高，斜率效率更高，可大幅降低所需的电流，进而提高了驱动器的切换速度。多结VCSEL虽然性能突出，但其多个PN结之间的连通难度也比较高，我司多结产品多样，性能优异。



激光雷达芯片

扫码登记参观

杰创半导体（苏州）有限公司 **6B09、6B10** **761nm VCSEL**

760.8nm波长 湿氧氧化式垂直腔面发射激光器 随电流可调谐2nm波长 低功耗 应用于氧气检测



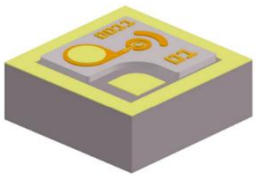
芯思杰技术（深圳）股份有限公司 **11B33** **25Gbps/50Gbps APD芯片**

该25Gbps/50Gbps APD光探测器芯片是GSG电极结构，为正面入光的高速雪崩光探测器芯片，光敏区尺寸分别是Φ16μm/Φ12μm。产品的主要特点是高倍增、低电容、低温度系数和高可靠性，主要用于25G PON、50G PON、5G无线和100G ER4。



浙江老鹰半导体技术有限公司 **13A26** **高速数据通信-VCSEL芯片**

老鹰半导体VCSEL芯片，850nm多模垂直腔面发射激光，拥有高可靠性、高一致性、低噪音、低阈值等特点。该款产品可应用于数据中心领域400G/800G光模块。



江西德瑞光电技术有限责任公司 **4B025** **VCSEL655/ 660/670/680/730/808/810/850/905/940/1064nm**

VCSEL 垂直腔面发射激光器 655/660/670/680/730/808/810/850/905/940/1064nm • 高效率和高可靠性 • 波长稳定，窄线宽 • 环形远场光束, 对称 • 表面贴装



激光雷达核心器件

扫码登记参观

苏州天孚光通信股份有限公司 13A65 激光雷达组件

如今随着5G技术和人工智能的快速发展，智能与网络快速融入我们的生活，被称为第二居室的自动驾驶技术迅速成为当前社会的首要发展的高科技产品；激光雷达做为自动驾驶最重要的传感器市场份额巨大，而在激光雷达内部主要的光发射接收组件均和光通信器件相似；结合光学镀膜/精密冷加工/无源自动化贴装测试等工艺平台，可针对激光雷达市场主流的机械转镜/FMCW/MEMS/OPA等各种方案提供相对应的解决方案。具有以下特点：1、高可靠性 2、损耗小 3、发散角小 4、光束质量高 产品应用：车载激光雷达中



福建信飞光电有限公司 5E15 C-Lens（激光雷达准直透镜）

光源耦合Laser Coupling:调节像差提高耦合效率，将激光器（LD）出射光汇聚入光纤中，接近非球面透镜效果。光纤准直器Fiber Collimator:制作特殊光纤或多纤准直器，降低插入损耗。



惠州市鼎新光电有限公司 1D46 激光雷达滤光片

扫地机器人、车载激光雷达等应用的808/905/940/1550窄带滤光片，支持定制。



武汉昱升光电股份有限公司 12C23 激光雷达及激光测距系列产品

激光雷达及激光测距系列产品 激光器解决方案供应商，可定制波长、封装、光功率等



1535/1550nm集成激光器

激光雷达光学元件

扫码登记参观

安力光电有限公司 10C77 激光雷达光纤激光器模块

Amonics的高功率光纤激光器（ALiDAR）系列提供了具有主振荡功率放大器的人眼安 全，单模，线性偏振纳秒脉冲全光纤激光源。它设计用于三维成像，风探测和测距等LiDAR系统。ALiDAR系列免维护，无需安装后服务。 它是适用于各种激光雷达应用的通用且耐用的激光源。 脉冲能量： ＞400uJ 1550nm人眼安全波长 脉宽100~1500ns 重频7KHz 窄线宽＜5kHz 低相对强度噪声＜150dBc/Hz



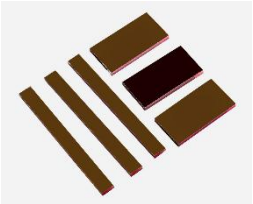
福建富兰光学股份有限公司 1A25 激光雷达光学元件

富兰光学研发的高精度激光雷达光学元件可全天候应对严苛环境要求，有效避免激光雷达系统信噪比降低，提高激光雷达系统探测及识别物体的准确率。



杭州科汀光学技术有限公司 5B53 激光雷达滤光片

应用于自动驾驶和TOF结构中的滤光片。同时在面部3D识别，检测，机器视觉等众多领域都有应用。



宁波欧泰神光科技有限公司 504 车载激光雷达光学元件

球面镜、柱面镜、准直透镜、转镜、反光镜、滤光片、加热视窗等光学件。

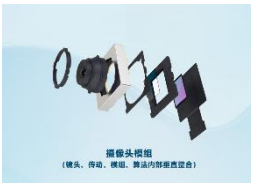


镜头模组

扫码登记参观

AAC Optics　3B51　摄像头模组（光学垂直整合）

摄像头模组产品通过自研的图像校准算法,在CMOS芯片上实现高像素高清晰度的拍照效果。同时,可将公司内部的镜头、音圈马达与光学算法等资源进一步垂直整合,实现硬件与软件的深度结合,能为终端客户提供全链路的光学系统解决方案。 模组产品线拥有CLASS 100级无尘车间及全自动化的高精密机台，能大规模完成摄像头模组的自动化封装。目前手机摄像头模组产品类型覆盖FF、AF、OIS、潜望，从前摄到后摄主/副摄等全系列，同时可提供无人机、运动相机、ARVR等非手机领域的摄像模组产品方案。



东莞市翰普电子科技有限公司　1B06　双目同帧同步六轴IMU机器人视觉模组

USB2.0双目摄像头，同帧同步，六轴IMU，200万30帧机器人免驱



惠州市合利诚科技有限公司　1D93　摄像头模组

1. 双目 / 立体视觉模组（深度感知） 核心差异：双镜头同步 + 基线算法，输出RGB + 深度图，实现三维测距、避障、活体检测。 2. 黑光 / 超星光级夜视模组（极低照度全彩） 核心差异：大底 + 高感传感器 + 大光圈 + 近红外增强，0.001lux 极暗环境下无需补光也能出彩色。 3.高动态 HDR、LED 闪烁抑制（LFM）模组 核心差异：逆光环境图像细节及曝光可控，清晰成像。 4. 全局快门（Global Shutter）模组 核心差异：全域同时曝光，高速运动无拖影、无果冻效应。



惠州市合利诚科技有限公司　1D93　摄像头模组

1. 双目 / 立体视觉模组（深度感知）
核心差异：双镜头同步 + 基线算法，输出RGB + 深度图，实现三维测距、避障、活体检测。
2. 黑光 / 超星光级夜视模组（极低照度全彩）
核心差异：大底 + 高感传感器 + 大光圈 + 近红外增强，0.001lux 极暗环境下无需补光也能出彩色。
3.高动态 HDR、LED 闪烁抑制（LFM）模组
核心差异：逆光环境图像细节及曝光可控，清晰成像。
4. 全局快门（Global Shutter）模组
核心差异：全域同时曝光，高速运动无拖影、无果冻效应。

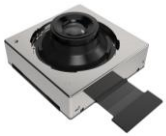


镜头模组

扫码登记参观

宁波舜宇光电信息有限公司 1B61 一英寸大光圈模组

业内首款一英寸大像面大光圈模组； 利用AOA主动光学校准技术实现模组高精度组装，提高模组大光圈性能； G+P镜头带来更好的画质，提升消费者拍摄体验。



视铂（上海）科技有限公司 6E71 S1-M 摄像头模组

紧凑型摄像头模组，包括专门设计的摄像头、板载内存和多光谱图像传感芯片 S1，经过生产校准，可实现更加准确一致的光谱响应。



深圳市联合影像有限公司 1A05 Unimage Pi

应用领域为以下： 智能终端 工业识别 智能安防 智能家居 智能支付 智能驾驶和交通 宠物监控 智能交通管理系统 智能健身器材和设备。



高瞻创新科技有限公司 3A22 微型防抖云台相机模组（MGS）

MGS 是一种专利机械稳定器，工作原理和传统云台一样，都是同时转动影像传感器及镜头，即使在低光环境下，也可以为穿戴设备提供出色的防抖性能。因为 MGS 体积细小，我们的相机模组的尺寸比最接近的竞争对手小40%，所以MGS能内置在大多数移动设备中。我们的核心弹簧和柔性印刷电路（FPC)专利技术成功把云台尺寸降至最小，补偿角度比传统的光学防抖(OIS)技术大至多700%，最大补偿角度可高达±8°，曝光时间能延长16倍，体积小巧，适合大多数小尺寸可穿戴设备。



光学镜头

扫码登记参观

深圳市永泰光电有限公司 1B21

永泰 YT-5018 1/1.8 8MP 1.0 黑光全彩高解析光学镜头

- 大光圈设计：F1.0的大光圈可极大增加通光量，使镜头在低照度环境下也能捕捉到更多光线，从而在黑夜等低光照环境中无补光依然呈现清晰全彩画面，让夜间成像如白天一样清晰。



东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 1C52

车载镜头

车载镜头涵盖DRM、DVR、OMS、RVC、SVC、ADAS等系列，广泛应用在碰撞预警、倒车辅助、全景系统、乘员监控等场景。



威海晟泰光电科技有限公司 1E31

25MM低畸变镜头

该镜头焦距25mm，光圈F2.8，M12×P0.5接口。采用全玻璃、设计，大景深、高分辨率的光学性能。支持1/4"至1/1.8"多种靶面尺寸，可灵活匹配IMX337、OV4689、AR0330等主流传感器。 适用于扫描识别、工业识别、人脸识别、无人机、运动DV、视频会议、打猎相机等场景。低畸变成像确保测量与识别精度，是视觉集成商的理想选择。



江西特莱斯光学有限公司 1B62

大光圈4K记录仪镜头

应用于高端行车记录仪（Dash Cam），搭配IMX678芯片，大光圈F1.70，4K画素兼广角140度，是Dash Cam视觉行业领域的主打产品。

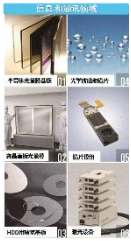


光学镜片

扫码登记参观

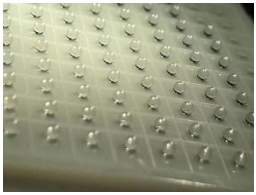
豪雅科技光电（亚洲）有限公司 5A51 光学材料/光学镜片

HOYA光学玻璃材料可为安防监控，车载，无人机，人脸识别，相机镜头，AR,VR,智能家居等相关的光学产品提供所需要的所有光学材料。（包括球面，非球面相关材料 非球面完成品，晶圆，蓝玻璃，偏光片等）



惠州市祺光科技有限公司 5D65-1 光学玻璃球透镜

我司光学玻璃球精度高、真圆度好、光学一致性优异，涵盖两大核心品类：光通信TO管帽专用高折射玻璃球，耐高温封焊、气密性佳，适配光器件封装耦合；低温模压玻璃球，低软化易成型，是精密非球面透镜优质坯料。产品尺寸精准、瑕疵率低，适配光通信、车载光学、安防、消费光电等场景，支持定制，可满足精密装配与规模化量产需求。



浙江蓝特光学股份有限公司 1A63 玻璃模造非球面镜片

高精密玻璃模压非球面镜片，应用于高清成像（车载、手机镜头）、车载激光雷达、激光准直模组、光通信模块、高清投影等等。



安徽尚欣晶工新材料科技有限公司 1D39 非球面玻璃镜片模套材料

非球面玻璃光学模套材料（无钴碳化钨）作为“2023年安徽省新产品”，打破了日本二十多年垄断，具有热膨胀系数与模仁材料匹配、可电火花切割加工、不易开裂、有效改变镜片偏心、优异的耐磨性能和不含低熔点添加剂等优势，已进入若干上市公司供应链，广泛应用于车载镜头、高端智能手机、无人机、机器人、AR/VR等领域。



光学元件

扫码登记参观

辰瑞光学 3B51

车载光学解决方案

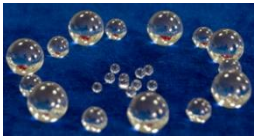
凭借先进的光学设计与精密制造能力，辰瑞光学可提供智能驾驶镜头及摄像头模组、智能座舱镜头及摄像头模组、智能驾驶激光雷达光学部件、AR-HUD光学部件、智能DLP前大灯光学部件等系列产品。在镜头方面，目前已拥有不同规格前视ADAS、环视摄像头、DMS/OMS等系列产品。能够有效实现车身360度场景感知，为机器视觉提供精准原始数据，以及满足座舱内精细化视觉感知系统提供精细化感知硬件。



四川格纳斯光电科技股份有限公司 5C85

车载、安防、人工智能片材/预制球

“棒、片、球一体化智能加工模式”，融合激光切割、自动化滚棒、压型、切割、抛光等多种技术，技术指标外圆0.5-30mm、真球度0.0005—0.005mm、公差精度±0.001—±0.02mm，外观光洁度美军标MIL：10-5，包装洁净度：模压前免清洗。



江西高瑞光电股份有限公司 1B71

球面/非球面透镜

我司拥有先进的非球面模压玻璃技术，将高温软化的小球通过精密模具压制成型，赋予非球面玻璃镜片独特优势。除了保留玻璃镜片的折射率、色散性和适应性，还能有效矫正同轴像差如球差、彗差和畸变，减少元件数量、简化系统，提升光学系统成像品质。 随着影像品质要求不断提升，对非球面镜片需求日益增加。我司倚赖先进的非球面模压技术，倚仗先进的非球面模压玻璃技术，我司引入数十台从韩国进口的模压设备，并拥有稳定良好的生产环境，为量产提供充足的保障。这让我们能够满足不断增长的市场需求，以卓越的品质和性能，满足客户的期望！



南通瑞森光学股份有限公司 5A65

透镜棱镜

瑞森光学可以生产平凸、平凹、双凸、双凹、弯月等透镜。也可生产直角棱镜、道威棱镜、分光棱镜、角锥棱镜等。

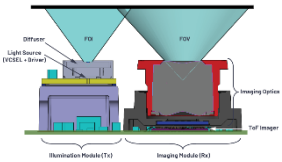


光学元件

武汉市元曦光子科技有限公司 3A72

dToF发射端匀光超表面 MetaToF-Tx®

针对dToF直接飞行时间传感系统发射端（Tx）开发的高性能匀光超表面器件。通过精密设计的超表面纳米结构，对VCSEL/EdgeEmitter激光光源进行高效光束整形与匀光处理，将高斯光束转化为能量分布均匀的平顶光束（Top-Hat），显著提升测距精度和有效作用距离。相比传统微透镜阵列（MLA）匀光方案，超表面匀光器具有厚度更薄（<0.3mm）、匀光均匀性更高（非均匀性<±5%）、光能利用率更优（>85%）等优势，且支持任意面形分布定制。已应用于多款dToF模组的Tx发射端，适配消费电子级量产需求



福建富兰光学股份有限公司 1A25

HUD光学元件

富兰光学利用先进自由曲面微纳加工技术和镀膜技术研发的HUD自由曲面镜，修正了挡风玻璃造成的图像畸变，从而保证成像不失真。更高精度，更大尺寸的AR-HUD自由曲面镜，不仅拥有了更大的可视角度，更实现了实景环境与虚拟信息的完美重合。



东莞如意光学科技有限公司 4D200、4D201

光学塑胶透镜

安防透镜，车载透镜，医疗透镜，红外激光透镜



山东赛恩吉新材料有限公司 9D85-2

车载 ADAS 激光雷达 / 毫米波雷达光组件专用改性工程塑料方案

适配车载摄像头镜筒、隔圈、4D 毫米波雷达波导板、激光雷达内部光组件的系列改性塑料方案，满足车规级机械性能与尺寸精度可靠性；相较金属材质实现轻量化，提升成型生产效率，拓宽整车结构设计自由度，有效降低零部件制造成本；PEI/PPS 改性料尺寸稳定性优异，适配自动驾驶车载光学传感全场景零部件。



光学材料

扫码登记参观

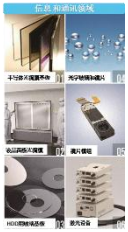
度恩光学（常熟）有限公司 7B52 车载专用镀膜材料

车载专用镀膜材料中，度恩的AF产品在车载、手机盖板玻璃和光学镜片等多种材质和镀膜层上表现出色。尤其在极限耐磨性、耐UV、耐酸碱和超爽滑方面，展现了卓越的性能。 车载镀膜材料，以SV-88作为打底层，再先后镀膜SV-55低折射，SV-80高折射和AF材料。目前已通过了高温高湿条件下防裂纹等全套高性能测试。 特别是，SV-88材料具有优秀的附着力，能够将基材和镀膜层牢牢抓住，从而显著提升整体信赖性。尤其在车载方面的信赖性要求条件中，耐UV测试上也表现出了理想的性能优点。



豪雅科技光电（亚洲）有限公司 5A51 光学材料，光学镜片

HOYA光学玻璃材料可为安防监控，车载，无人机，人脸识别，相机镜头，AR,VR,智能家居等相关的光学产品提供所需要的所有光学材料（包括球面，非球面相关材料 非球面完成品，晶圆，蓝玻璃，偏光片等）。



帝人株式会社 1B01 光学镜头用树脂-SP系列

"Panlite"SP系列是专门为光学镜头开发的材料。 光学镜片树脂 - SP规格一 同时实现了高折射率和低双折射,适合相机的小型薄壁化高性能化的趋势。同时还具有高耐热性，非常适合于对长期可靠性有要求的用途。



上海昀通电子科技有限公司 1C75 Aventk 1126K12手机摄像头AA胶

Aventk 1126K12 是一种紫外光加热双固化环氧丙烯酸体系胶黏剂，能够快速光固化。它是一种单组分，无溶剂的环氧丙烯酸胶黏剂。UV后它可以提供初始的固定粘接强度。热固后在LCP、PC、NTB等塑料材料上具有出色的粘结强度，耐受长期的老化，老化后衰减小。是专门为手机摄像头模组AA制程开发的胶黏剂。



HUD

扫码登记参观

舜宇车载光学 1B61 HUD PGU

车规级品质 高亮度 高分辨率 高对比度



奥提赞光晶（上海）显示技术有限公司 2A176 AR-HUD 大尺寸光波导

为顺应新一代汽车的发展对智能座舱交互显示的需求，奥提赞开发出大面积体光栅光波导的企业，该产品用于AR-HUD，具有体积小、视场角大、投影距离远、光学效率高等特点。



中光学集团股份有限公司 5B68 AR-HUD

主要参数： 分辨率 800x600 （3.1TFT） 视场角(FOV) 9°x3° 虚像距离(VID) 7500mm 最大亮度 12000nit 对比度 1200：1 先进的增强现实型抬头显示系统，将导航指引、车速等关键驾驶信息以高精度、强沉浸感的方式叠加融合于真实道路视野前方，显著提升行车安全性与情境感知能力。



芜湖长信科技股份有限公司 2D180-1 LCOS HUD

"核心功能 LCOS 光机透射成像，作为 HUD 显示源 关键参数 亮度≥13000nit，均匀性≥90%，高清晰度 体验建议 可对比强光 / 弱光环境下成像效果，观察图像均匀度 适配场景 车载 HUD、航空 HUD 等"



HUD

扫码登记参观

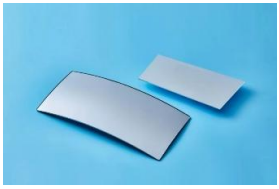
尼卡光学（天津）有限公司 2A136 体全息光栅波导元件（用于车载AR-HUD）

传统车载HUD设备普遍存在体积臃肿、成本高昂、易引发阳光倒灌等问题，尼卡光学利用光波导技术来实现扩瞳，增大视场角的同时大幅缩小HUD整机体积，天然无阳光倒灌问题；同时体全息光波导VHG可大面积制备，成本可控、性价比高。 尼卡光波导采用体全息光栅（VHG）来实现对车载HUD厂商的深度赋能，为高阶智驾显示奠定基础。使用尼卡方案的车载HUD设备具有光效高、高画质、体积小、成本低等优势，平台化设计可适配所有车型，是当前智能座舱的优选方案，目前尼卡正与主机厂&Tier1联合开发相关产品中。



湖北三海光学有限公司 1D69 车载HUD

HUD镀膜用途 高反膜：提高反射率，增强HUD抬头显示器的投影亮度和清晰度，确保信息在强光下也能清晰可见。 增透膜：减少光线反射，进一步提升显示清晰度，让驾驶员能更轻松地读取信息。 硬化膜：增强玻璃表面耐磨性，延长使用寿命，保护镀膜不受损伤。 导电膜：用于防雾、抗静电等功能模块，确保HUD在各种天气条件下都能正常工作。 确保在各种环境下都能提供清晰、稳定的信息显示，提升驾驶安全性。



维达力科技股份有限公司 3A50 HUD自由曲面镜

自由曲面镜是HUD的核心部件，我司采用玻璃替代传统注塑件，在热稳定性、尺寸精度、抗形变、面型精度等方案有绝对优势； 本产品核心指标：ARHUD 面型 PV＜150um，可见光反射率＞92%，可实现高反膜、红外截止膜等镀膜要求，长期1000H以上耐久测试前后膜层及面型稳定。



南京平行视界技术有限公司 2D011、2D012 二维彩色PVG-HUD光波导

长期以来，HUD传统光学方案受制于物理定律的桎梏，始终无法在成像距离、画面尺寸与系统体积之间找到平衡点，这也成为制约 AR-HUD 向高阶形态发展的核心技术壁垒。我们自主研发的偏振体全息（PVG）光波导技术，具备大视场角、大出瞳、小体积等先天优势，并且通过单层波导即可实现全彩显示,通过创新的微纳光学架构彻底打破了这一僵局，不仅能在同等显示效果下将 HUD 系统体积压缩一半以上，更凭借成熟的全链条量产工艺实现了成本的大幅优化，为车载HUD显示的大规模普及铺平了道路。



新型显示技术

扫码登记参观

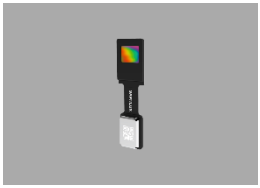
长沙睿显科技有限公司 2C135 硅基OLED微型显示屏

睿显科技主营0.13–1.3英寸硅基OLED微型显示屏，依托专业技术团队与国际化运营体系，自主掌握硅基CMOS驱动、阳极像素架构、OLED发光层设计、薄膜封装等全产业链核心技术。 Micro OLED具备高分辨率、高亮度、广色域、低功耗、耐环境等突出特性，广泛适配AR/VR/MR头显、智能穿戴、消费电子、医疗可视化、工业机器视觉等领域。睿显科技可输出显示模组至系统集成一站式光电定制服务，全方位服务全球各行业客户。



西安赛富乐斯半导体科技有限公司 2D106、2D107 T3-0.13英寸单片全彩Micro-LED微显示屏

T3-0.13 英寸是赛富乐斯（Saphlux）发布的第三代单片全彩Micro-LED 微显示屏，专为 AR 眼镜等近眼显示设备设计，核心是用自研NPQD®（纳米孔量子点）技术实现单片蓝光晶圆直接全彩化，在亮度、功耗、体积与成本上形成代际优势。



微玖(苏州)光电科技有限公司 2D115 0.13inch R/G/B微显示屏

VIJO 0.13系列R/G/B单色Micro LED微显示屏，具有高亮度、低功耗、高分辨率、高可靠性、微型化的特点。屏幕通过硅基背板驱动每个 LED 像素，尺寸为 0.13 英寸，分辨率 640*480，像素密度为6350PPI，信号接口支持 MIPI/QSPI 通信算法处理。产品适用于AR近眼显示、微投影等应用场景。



南京国兆光电科技有限公司 2D126 QHD065系列硅基OLED微显示屏

QHD065系列产品分辨率为2560×1440，显示尺寸为0.65”，像素尺寸为5.67μm，具有高亮彩色、高色域、低功耗等产品特点，为公司在AR/FPV眼镜领域的一款大视场角、高分辨率产品。



新型显示技术

扫码登记参观

南京芯视元电子有限公司　2C130　LCoS显示模组以及驱动芯片

芯视元的LCoS显示模组尺寸从0.26、0.37、0.39英寸，到0.52、0.69英寸，分辨率从720P到1080P，驱动芯片分为模拟和数字两种方式，输入信号涵盖MIPI和RGB888，是目前国内规格型号最丰富的厂家，并且芯视元自建LCOS后道液晶封装生产线，贯通设计与生产环节，实现100%纯国产，并且进行全生命周期的质量管控，确保产品性能稳定可靠。



上海冠显光电科技有限公司　8D41、8D42　1.03"微型显示模组

1.03 英寸，分辨率：2560*2560 亮度：1800/3000/2000nit 显示区域：18.432*18.432 (mm) 接口：MIPI 刷新率：90HZ 颜色：RGB



浙江宏禧科技有限公司　2D105　硅基 Micro OLED 微型显示器

产品主要应用于 VR/AR 观影、游戏、教育、工业、医疗与文旅展览等领域。



苏州智聚芯联微电子有限公司　2D170　65寸LCD空间现实显示终端

JUPITER 65寸空间现实显示终端是一款采用纳米级柱状透镜光栅技术的裸眼3D设备，无需佩戴眼镜即可体验逼真的立体影像。它配备65英寸8K超高清LCD屏幕，支持60个独立视点，在130°宽广视角内呈现通透、无重影的3D效果。 其核心亮点在于自研AI算法，可将普通2D视频内容实时转换为3D效果，并自动生成景深信息，操作便捷。产品采用高强度铝合金一体成型外壳，设计简约，并具备出色的环境适应性，可在0℃至50℃环境下稳定运行。无论是博物馆展陈还是商业展示，它都能以震撼的视觉效果成为焦点。



视觉传感器

扫码登记参观

艾迈斯欧司朗 6A59

TMF8829 直接飞行时间（dToF）传感器模块

超低功耗创新、精度升级、应用更广泛：艾迈斯欧司朗发布TMF8806直接飞行时间（dToF）传感器模块　为家用电器、移动机器人、相机自动对焦、楼宇自动化、库存管理系统、安全系统及虚拟屏障提供卓越的速度与精准度　实现高精度、低功耗的测量，拥有极快的响应时间，确保出色的分辨率与精确度　TMF8806尺寸小巧，可轻松集成于空间有限的应用中



浙江水晶光电科技股份有限公司 2C115

dTOF模组

产品优势：　1、超广角视场 水平FOV>110°　2、远距离测量能力 室内>10m 黑靶10%反射率，室外100klux阳光下测距 >4m 黑靶10%反射率 3、低功耗<1.5W 4. 轻小低成本 5. USB输出高帧率>10fps 6. RBGD对齐



虹科电子科技有限公司 6C07、6C08

ChipSense™ 光谱传感器芯片

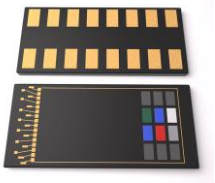
友思特 Chipsense 光谱芯片，依托磷化铟（InP）晶圆制造技术，提供覆盖可见光与短波红外（500nm-1700nm）的超宽光谱范围。其采用16通道、每通道4峰值的单点检测宽响应架构，能够采集丰富的光谱数据，并借助算法平台实现材料的精准分类与定量分析。该芯片支持大批量集成于手持检测设备、工业产线检测、智能家电、电子健康设备等场景，实现实时、低成本、非接触且无损的材料分析。目前，Chipsense芯片已在华为、博世等企业完成功能测试验证。



美芯晟科技（北京）股份有限公司 6A41

屏下色温和接近传感器芯片

超高灵敏度的OLED屏下色温和接近传感器芯片MT3321，专为OLED屏幕设计，可无缝集成于屏幕之下，集环境光强度检测、色温感应与接近检测功能于一身，实现三功能合一的便捷体验。MT3321采用紧凑的OLGA16封装技术，尺寸仅为3.32mmx1.7mmx0.6mm，轻松适配手机、平板电脑、智能手表等多样化智能终端，满足全面屏的应用需求。此外，该芯片还具备超低功耗模式可最大程度的增强整机电池长续航能力，以及高阶的抗环境光干扰技术和多路独立并行触发采样逻辑技术能够实现精确的光强度、色温和接近检测。



视觉传感器

扫码登记参观

深圳北极芯微电子有限公司 6C56

DTS6004 dToF传感器微型模组

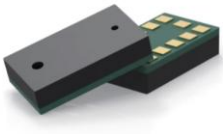
DTS6004是一款单通道dToF（直接飞行时间）SiP微型模组，集成了北极芯微研制的高性能dToF SoC以及VCSEL发射器，支持2×2分时分区获取距离数据，分区模式下能够实现5.5m范围内的高精度距离测量，帧率可达7.5fps。DTS6004基于高性能SPAD传感器，片内集成高精度TDC和协处理器，可以高效地进行距离测量。DTS6004采用940nm激光，符合1类人眼安全要求。采用单电源供电，并基于I²C接口进行数据通信，易于集成和使用。



南京芯视界微电子科技有限公司 6C51

单光子1D-dToF传感器VI5301

VI5301 直接飞行时间（dToF）传感器采用单模块封 装设计，集成了单光子雪崩二极管（SPAD）接收阵 列以及 VCSEL 激光发射器。该传感器可对物体进行 精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响，为市场上的微型 ToF 传感提供了紧凑的解决 方案。



武汉聚芯微电子股份有限公司 6D60

3D-iToF图像传感器芯片

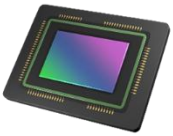
精准获取三维空间距离、深度图像信息、目标轮廓形态，凭借超高精度与稳定性，广泛应用于消费电子、智能穿戴设备、智能家居、具身智能、物联网等多个场景，为各类智能设备赋予精准的空间感知能力。



宇勘复芯(广东省横琴粤澳深度合作区)科技有限公司 6B86.33、6B86.34

仿生视觉传感芯片（DVS）

对于高速运动的目标，传统帧同步成像和感算分离的架构已无法满足系统应用场景的要求，研制感算一体的仿生动态视觉传感系统芯片成为应对此类场景的有效途径。



视觉传感器

扫码登记参观

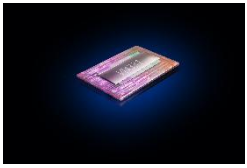
杭州纳境科技有限公司 1A68 超表面DTOF测距产品

纳境的超透镜近红外测距模组，镜头采用半导体工艺制程，可实现精准测距。产品可应用于消费电子、扫地机器人、无人机等领域。



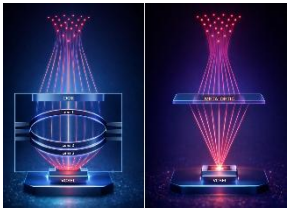
南京芯视界微电子科技有限公司 6C51 一款面阵dToF传感器 VI4331

VI4331是一种直接飞行时间（ToF）成像传感器，集成了240x96个单光子雪崩光电二极管（SPAD）像素阵列、前端时间数字转换器（TDC）和深度DSP处理器。通过脉冲激光发射器的组合，该传感器可以返回一个240x96的深度图像。该传感器提供支持直方图模式和DSP模式像素数据格式的MIPI CSI-2接口。



武汉市元曦光子科技有限公司 3A72 dToF接收端超表面MetaToF-Rx®

针对dToF直接飞行时间传感系统接收端（Rx）开发的大面阵/多点超表面光学器件，覆盖两种核心规格：①大面阵Rx超表面——针对SPAD/SiPM大面阵探测器，通过超表面的大视场相位调控实现全阵列均匀聚焦，在同等模组体积下有效接收视场角（FOV）较传统Rx镜头提升30%以上；②多点Rx超表面——针对多点dToF架构，通过分区相位设计实现多通道独立聚焦，各通道间串扰<-40dB，支持4~64通道灵活配置。



深圳市芯朝网动电子有限公司 2D125 佳能CMOS影像传感器

●高分辨率CMOS、机器视觉/监控的产品系列。 ●高像素（2.5亿、1.2亿） 4K8K FPD检测、广域监控 ●全局快门（1900万、500万）工业检测、安防监控、电影制作



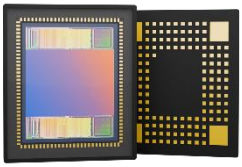
图像传感器

扫码登记参观

深圳北极芯微电子有限公司 6C56

PCM7200 光子计数成像传感器

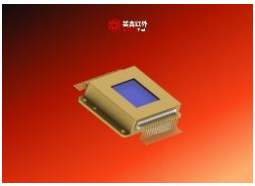
PCM7200是一款具有3.2MP分辨率的图像传感器，主要特点是像素采用了先进的PCI光子计数成像技术，其感光区集成了2080Hx1568V个3D堆叠背照式SPAD器件。基于领先的SPAD器件性能和特殊的低功耗曝光技术，可同时兼顾微光、HDR和高帧率应用场景，并且其典型功耗低至200mW(@1MP)。 芯片使用多种图像传输接口，包括MIPI CSI-2、LVDS和DVP接口；芯片具有灵活的多区ROI功能，片内集成了坏点滤波、多像素binning等图像处理功能;芯片功能统一使用I²C接口进行配置。



武汉英睿红外科技有限公司 8E22、8E23

量子点短波红外图像传感器 IR-S1210A

具备 0.4–1.7μm宽光谱响应、CMOS兼容单片集成及规模化制造能力，支持多种阵列规格与读出架构，可应用于材料识别、温度测量、多光谱&高光谱成像及智能感知等领域。 核心功能： 阵列规模1280*1024 | 像元间距10μm | 有效像元率≥99.5% • 波段灵活可调：可根据需求定制目标响应波段 • CMOS单片集成：支持大面阵、高分辨率图像传感器开发及规模化制造 • 低功耗设计：适用于便携设备、嵌入式视觉系统及边缘感知终端 • 灵活架构兼容：支持定制ROIC设计及多种单片/异质集成方案



视铂（上海）科技有限公司 6E71

S1 多光谱图像传感器

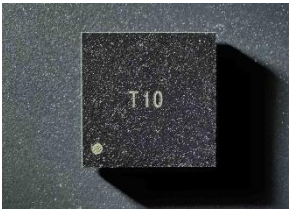
全球首款真正实现小型化且可大规模生产的多光谱图像传感器，具有 15 个色彩通道，能达到高光谱分辨率，光谱范围 400nm 至 700nm，全 CMOS 集成带来高稳定性。



杭州极钛微电子有限公司 8E116、8E117

T10系列高性能热成像图像处理专用芯片

T10系列是针对红外热成像图像处理专用ASIC芯片，具有小尺寸、低功耗、高集成、高性能等特点。集成专用红外图像处理ISP模块，在信噪比、动态范围、图像增强等方面均有优异的表现。支持主流红外探测器输入，同时集成丰富的输出和外设接口，满足各种应用场景需求。T10集成了高效的神经网络推理引擎，可实现AI超分、AI ISP等AI应用。

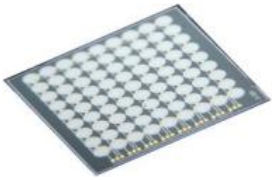


MEMS传感器

扫码登记参观

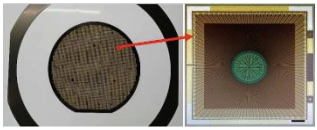
联合微电子中心有限责任公司 8C45 MEMS声压传感芯片

MEMS声压传感芯片基于压电原理检测技术，采用MEMS工艺制造，兼具高灵敏度与高一致性，工作频带内灵敏度无衰减，主要适用于水下传感器，可用于海洋预警、海底测绘等领域。



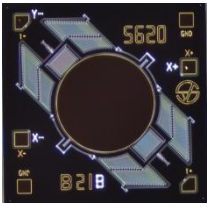
微集电科技（苏州）有限公司 8C06、8C07 红外气体探测专用MEMS芯片

采用MEMS技术制作的新型热电堆式红外气体探测专用芯片，在不同气体特征波长范围内，具有高红外响应率、低响应时间、高稳定性和一致性等特点，可探测CO2、CO、NOx、SO2、CH4、SF6等多种气体。



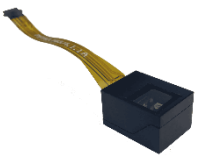
无锡微视传感科技有限公司 6E46 MEMS光开关芯片

MEMS光开关芯片 采用静电驱动单轴或双轴偏转MEMS微镜，基于成熟半导体硅工艺制备，具备良好光学性能与热稳定性，是光通信NxN光开关的核心芯片，可供封装于TO46管壳。



苏州知芯传感技术有限公司 6E39、6E40 MEMS结构光投射模组-红外（ZX-M020C-IR）

ZX-M020C-IR 是基于单轴 MEMS 微镜的结构光扫描模组。模组配备 854nm 窄带半导体激光器，拥有比LED 光源更窄的带宽，配合滤光片使用，具有更高的对比度，能更好的抗环境光干扰。该模组可作为 3D 深度相机结构光投影部件，组成单目、双目结构光相机。具有大视野、高扫描频率、体积小、重量轻的优势，可应用于消费级手持扫描仪、焊接引导、机器人导航等领域。 产品特点： 扫描角度FOV：50°× 60° 光源：850nm±10nm 出光功率：160mW 线宽：<0.7mm@500mm



光源

扫码登记参观

无锡亮源激光技术有限公司 4B095 激光雷达光源

微小型光纤光源(脉冲光纤激光器)在保证测距所需功率前提下，对体积、重量、功耗等各方面进行深度优化，是目前业界功耗优化、结构最为紧凑的激光雷达光源之一，适合作为机载遥感测绘、激光测距机、ADAS车载激光雷达等应用小型化激光光源。



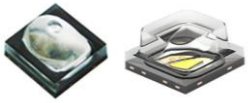
北京博米科技有限公司 1A20 图像测试用光源

博米科技自主研发光源系列，包括反射光源、透射光源、箱式光源（标准QC光源、实景灯箱、HDR实景灯箱、动态HDR实景灯箱、三面箱式光源、微光旋升光源箱等）、球形光源、多光谱光源、点光源（高亮度眩光测试点光源、杂光鬼影双点光源、准直太阳灯点光源等）、太阳灯光源、紫外光源、产线光源、低照广角测试系统等，光源系列色温、照度、光谱曲线、波长、尺寸均支持定制。光源色温照度可调，拥有高显指，并可复现任意光谱曲线，可定制365-1500nm任一波长。可模拟一天中不同时段的光线变化，让测试结果更精确。



深圳循光科技有限公司 6A49 车载照明与光传感应用产品

本产品为严格遵循车载AEC-Q102标准开发的专用贴片LED器件，覆盖DMS驾驶员监测红外光源、车身外饰照明光源两大核心品类。产品搭载定制化聚光透镜光学结构，兼具车载严苛环境下的高可靠性、精准光学输出能力与小型化集成优势，是智能座舱、整车外观照明系统的核心配套光电器件。 特点 1.全面解决光学及结构痛点，满足座舱内不同场景应用 2.简化光学和散热结构，实现系统降本 3.技术创新降本可规避传统材料降本带来的系统可靠性风险 4. DMS红外补光+车身饰灯照明，提供一站式车载光源配套



车载应用光源

莱赛激光科技股份有限公司 4C057 白激光车灯

莱赛激光推出的LRW系列白激光车灯、白激光辅助车灯采用留美博士发明、具有专利技术的白激光光源，进行特殊的反射式设计，生产的白激光车灯具有安全性好，亮度高、准直性好、照射距离远的特点，改善汽车或摩托车前灯的照明范围及亮度，大大提升了驾驶者在照明条件不佳的环境下的行车安全性。



红外技术

扫码登记参观

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 8A59

中波制冷热像仪

110-1100mm连续变焦中波制冷热像仪主要用于远程观测。使用了高灵敏度的中波制冷机芯，该机芯分辨率为640*512，可以产生高分辨率的清晰图像；这款产品中使用的110mm-1100mmF5.5连续变焦红外镜头能有效区分远距离目标。例如10公里以外的人，15公里以外的车，20公里以外的船只等。



浙江华感科技有限公司 8B35

华感热成像机芯 Zino 系列

数字机芯 Zino 系列 采用业界领先的非制冷氧化钒焦平面探测器（分辨率可选384x288/640x512），灵敏度高，图像质量好。该系列支持多种焦距镜头，并配备BT1120数字视频接口、CVBS及串口通信，接口丰富，使用方便。它支持FPNC、SFPC等图像优化算法，以及亮度、锐度、伪彩、增益等功能设置，画质更清晰。同时支持配置保存、热图导出，便于二次开发，可广泛应用于工业、农林业、医疗、交通、电力、消防、建筑、安防等领域。



浙江大立科技股份有限公司 8B51

非制冷焦平面探测器

由大立自主研究开发的非制冷红外焦平面探测器，经过多年的努力，现已实现产业化生产。产品采用CMOS-MEMS工艺，具有响应快、分辨率高、像元间距小、灵敏度高、固定图形噪声低等优点。适用于测温、监控、车载夜视等多种领域。



武汉英睿红外科技有限公司 8E22、8E23

量子点短波红外相机 IR-S01210AG

搭载自研量子点图像传感器，兼具宽光谱响应、高图像质量及工业级可靠性，支持规模化部署与多场景应用。 核心功能： 分辨率1280*1024 | 像元间距10μm | 功耗≤4W @Max. cooling • 宽光谱响应：主要基于量子点传感器，覆盖0.4–1.7μm波段，支持多光谱成像与物质识别 • 波段灵活可调：光谱响应可根据需求灵活优化 • 优质图像输出：低噪声，高动态范围，精准还原目标物本质特征 • 具备更优的成本与量产潜力 • 稳定可靠的工业设计：TEC控温，保障高负荷连续工况下的长期可靠性



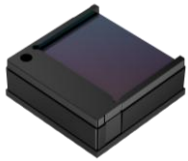
红外技术

扫码登记参观

烟台睿创微纳技术股份有限公司 8B59

行业首创SWLP 8微米红外探测器 OHLE 6081

非制冷红外焦平面探测器OHLE6081基于氧化钒微测辐射热计技术研发，采用新一代8μm像元技术，较同分辨率陶瓷封装探测器体积缩小74%；行业首创SWLP技术，支持高效贴装与大规模批量生产。640×512分辨率，11.2*11.2mm紧凑型设计，兼顾高画质、小体积、低功耗与宽温测温，可快速嵌入各类红外热成像终端设备，为民用行业无人机、工业测温、户外夜视、辅助驾驶等领域提供高性能、低成本、易量产的核心器件方案。



武汉高德红外股份有限公司 8A49

车载红外一体机

车载红外一体机是轩辕智驾2026年推出的后装新品，该产品无需外接算力即可独立运行AI智能预警，支持行人、车辆、动物实时识别与观瞄显示。产品集CVBS、AHD、UVC、GMSL多协议于一体，兼容主流车机与记录仪，适配性大幅提升。可支持AI超分算法，提升图像清晰度。 同时，整机采用小型化一体设计，支持256/640等多种分辨率及镜头选配，并可深度适配车机APP，满足不同场景的便捷安装与智能视觉需求。



杭州光鸿科技有限公司 6D27、6D28

红外热成像模组

红外热成像模组 & 可定制化光机电零配件 1.红外镜头+机芯 2.自动对焦板/SDI+CVBS迷你编码器



嘉兴真与科技有限责任公司 6E63

AetoSight™ 新一代 AI 微光全彩夜视机芯

真与科技提供软硬一体化”套壳即用”完整解决方案，将 ZY1010 AI ISP 优化、PixoClean 算法适配及极端场景调试封装为模块化组件，企业仅需通过标准化接口嵌入机芯，即可直接调用 AetoSight™ 的 0.001Lux 全彩夜视 + 噪声抑制 + 动态范围增强”全栈能力，可无缝集成于夜视仪、打猎相机、无人机及安防监控设备，赋能多行业应用，助力企业夜视仪产品迅速完成从低端制造向中高端智造的转型升级。



车载光通信

扫码登记参观

厦门光莆电子股份有限公司 11T52-2 车载光通信模块

车载光通信模块｜智能汽车高速光互联 · 车规级设计，10G/25G高速传输，**-40℃~105℃** 宽温、强抗振、零电磁干扰； · 替代铜缆，减重降扰，适配域控、激光雷达、高清屏； · 低时延、高可靠，参照AEC-Q102标准设计； · 为高阶智驾与智能座舱提供高速、稳定的光通信保障。



天津科谱技术有限公司 11D58 车载光通信解决方案

基于25G VCSEL激光器芯片的BOSA产品，支持980/850nm上下行波长方案，面向车载低功耗、低成本、小型化、轻量化应用需求，预计2028Q1实现量产；全球首款车载25G PON光网络MAC芯片，符合多家车厂新一代智能驾驶、智能座舱应用需求，适配多种车载AI算力芯片及传感器终端，预计2028Q1实现量产；为客户提供车载25G PON光网络协议栈、子系统等全套解决方案。



三菱电机机电（上海）有限公司 12B727 车载光通信用DFB chip

随着汽车EE架构向中央计算演进，L3/L4自动驾驶催生海量数据传输需求，传统铜缆已逼近10Gbps物理极限。"光纤上车"成为解决高带宽、轻量化、抗电磁干扰的关键路径。本款车规级DFB激光器专为车载光通信设计，具备单纵模输出、高边模抑制比及卓越温度稳定性，完美适配车载光纤以太网与光PON系统，为智能汽车提供稳定可靠的光信号源，助力"光纤上车"加速落地，抢占千亿级车载光通信市场先机。



惠州乐庭智联科技股份有限公司 9C22 车载以太网线

该产品为车载以太网线，由两根芯线对绞形成，外层有铝箔麦拉，镀锡铜屏蔽以及PVC外被。主要运用于汽车中控屏的信号传输以及自动驾驶



车用芯片

扫码登记参观

浙江睿熙科技有限公司 6C41

车载VCSEL芯片及多结VCSEL芯片

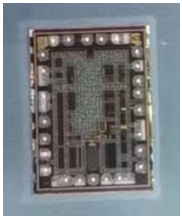
睿熙科技车载产品涵盖智能座舱和智能驾驶完整产品布局。 睿熙科技多PN结的VCSEL激光器，优点是发光效率比较高，斜率效率更高，可大幅降低所需的电流，进而提高了驱动器的切换速度。多结VCSEL虽然性能突出，但其多个PN结之间的连通难度也比较高，我司多结产品多样，性能优异。



上海米硅科技有限公司 12D53

车载摄像头解决方案 – ms56100 & ms57020

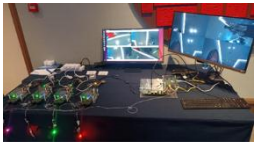
ms56100：一款专为车载摄像头设计的高性能接收端芯片，支持10G HV TIA，确保图像数据的高速、高清晰度传输。



鹏瞰集成电路（杭州）有限公司 12D75

车载光通信芯片及演示系统

基于鹏瞰TS-PON SoC芯片搭建的10G/25G全光车载通信系统，具有车载MIPI摄像头接入，推屏功能、CAN/LIN车载控制器接入，完美契合车载Zonal架构的演变。端到端μ秒级通信时延为L3~L5 自驾奠定了基础，并极大简化了车内布线。在国内车企、Tier1以及光通信产业链伙伴大力推动下，全球独创的首批“光纤上车”的车辆在不久的将来即将问世。



厦门优迅芯片股份有限公司 11C33

10G车载光通信收发方案
2.5G车载光通信收发方案

10G车载光通信收发系列套片，2.5G车载光通信收发系列套片

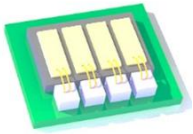


车载器件/模块

扫码登记参观

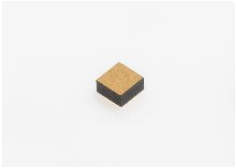
苏州苏纳光电有限公司 13A61 硅电容

为抓住激光雷达市场与光器件、光芯片产业融合的发展趋势，苏纳光电将隆重展示先进的硅电容解决方案。硅电容基于薄膜半导体技术，可以实现小体积和超薄厚度，具备高频、耐高压、耐高温、随电压和温度变化容值稳定等优势。在车载激光雷达场景中，有助于实现激光雷达回路小型化和延长探测距离。此外也被广泛应用于智能手机、高速光模块、射频功放等领域。



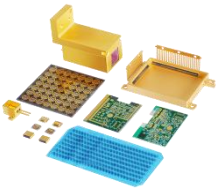
浙江富乐德传感技术有限公司 13C91-2 微芯片热敏电阻

NBC热敏电阻｜光通信温控专家 日本精工淬炼2层金电极，实现激光二极管温度监测。具备宽温域适应性，专为严苛环境设计（-40℃至+125℃）。通过长时间高温信赖性测试。耐热性强，切变强度较大，耐拉性强度大。历经25年深海高压、强腐蚀环境考验，海底光缆性能无损；保障数据快速传导，设备高效稳定运行，提升系统整体性能。适配车载激光雷达场景，保障光模块稳定运行。用温度精度定义传输边界，赋能全球高端制造。



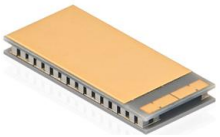
合肥圣达电子科技实业有限公司 12C72 车载激光雷达封装外壳

车载激光雷达封装外壳，该系列产品主要应用于智能汽车的自动驾驶领域，为车规级激光雷达提供高可靠一体化封装方案，公司深度绑定行业内龙头企业，根据客户不同激光雷达路线（机械式/OPA/MEMS/FLASH），可接受个性化定制。圣达科技凭借自身的研发优势，解决了高导热氮化铝基板上的复合膜系制备、瞬时大电流高热量冲击下的系统级散热难题，赋予了车载激光雷达高可靠性封装，加速了车载激光雷达大规模商业化的速度，推动中国自动驾驶技术引领全球。



广东富信热电器件科技有限公司 11D67 微型热电制冷器件 （Micro TEC）

典型应用于光通讯传输网10G DWDM光模块、100G LR4/ER4/ZR4光模块、相干模块、数据中心400G/800G光模块以及车载激光雷达等。产品支持金锡焊料和非气密性封装。





重点展示测试测量及检测

展示范围：检测仪/检测设备

检测仪/检测设备

扫码登记参观

杭州源现科技有限公司 2C106 HUD系列检测设备

面向车载HUD功能测试，提供双目自动对焦方案，相比于双目定焦解决方案，能够实现自动快速的焦面切换，完成不同焦面的虚像测试，测试项目包括亮度、颜色(色坐标，色温等)、 均匀性、对比度、虚像长宽、视场角、虚像距离、清晰度、重影、倾斜角、畸变、下视角等。



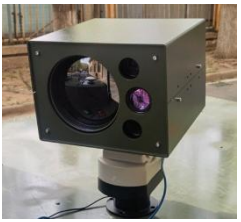
珠海广浩捷科技股份有限公司 1A71 车载摄像头标定与测距设备

车载摄像头标定与测距设备 本系列涵盖内参标定与三角测距两款独立设备，兼容30°~220°全视场角相机模组，支持鱼眼、针孔、全向等多种畸变模型，适配单目/双目/三目全品类产品。 内参标定设备：全自动标定系统，模块化载具上下料，搭配球面并联机械手旋转机构。支持双环境标定模式——中继镜头模式（30°~120°）与实景环境模式（120°~220°）。快速换型，升级套件灵活适配。 三角测距设备：全自动测距系统，小型化设计节省场地，单工位UPH > 240，双工位UPH > 300。搭载三轴旋转系统与模块化上下料机



长春理工大学 6C86 车载多谱段偏振成像探测装置

针对光电探测在复杂环境下，对低对比度等目标存在探测能力下降的问题，研制一款用于车载的多谱段目标偏振成像观瞄系统，实现多谱段目标偏振信息采集与高对比度图像的获取，具备在烟尘、雾霾等复杂观测条件下实现全天候目标成像探测与识别功能。



合肥知常光电科技有限公司 3C71 多光谱智能透镜外观检测仪

多光谱智能透镜外观检测仪(AOSI-4000S)，主要用于各类光学元件，光学晶体，光学陶瓷的全自动表面质量检测。 本设备自动化程度高，批量上料，自动送检，智能检测，根据检测结果智能分拣，并生成统计日志。检测结果可根据需求进行保存，保证检测结果可溯源性。





重点展示生产制造设备

展示范围：智能装备



智能装备

扫码登记参观

东莞触点智能装备有限公司 10B69

AP-Smart Inline 半导体封装智能整线

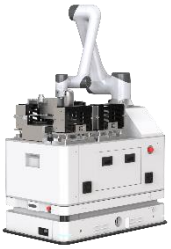
AP-Smart Inline 半导体封装智能整线 全自动COB封装解决方案，以高智、高稳、高速、高精为核心优势： ±7μm超高精度贴合，兼容正装/倒装芯片工艺； 车规级零缺陷管控，Class 10洁净环境保障品质 产能提升30%+，设备综合效能（OEE）行业领先 自动化无人整线，支持灵活配置与MES全流程追溯 量产验证可靠：8+年以上大规模稳定运行经验 创新升级：兼容车载COB工艺。



御鼎（苏州）智能电子有限公司 10D80

AMR（自主移动机器人）

具备自主决策和环境感知能力，可在工业制造和物流仓储领域中自主避障和动态规划路径



宁波尚进自动化科技有限公司 10D32

ZH6000系列全自动深腔键合机

ZH6000系列产品是尚进自动化自主研发的全自动深腔键合机，凭借高速精密的结构设计和先进的自动化及运控技术，可实现精准搞笑的引线键合，满足多样化焊接需求。 ZH6000系列全自动深腔键合机可适用于分立器件、微波组件、激光器、光通讯器件、传感器、MEMS、声表器件、RF模块、功率器件等领域。ZH6000-B全自动深腔键合机用于球焊键合，适用劈刀长度为16mm、19mm；ZH6000-W全自动深腔键合机用于楔焊键合，适用劈刀长度为19mm、25mm。



苏州光舵微纳科技股份有限公司 2A108

全自动滚轮纳米压印设备

一款全自动纳米压印设备，兼容8inch、12inch基板，可便捷更换；整机采用模块化设计，集成EFEM、spin coater、HP、CP、NIL、Frame loading Unit、Pre-aligner、RF-reader等功能模块，可根据对量产能力的需求，增加子模块，具有良好的拓展性；配合光舵自研的智能操控软件，所有动作均可全自动完成；压印最小线宽30nm ，深宽比达10：1，与母版尺寸偏差＜3%，对位精度± 2um；同时具有优良的生产稳定性和class10级高洁净等级。

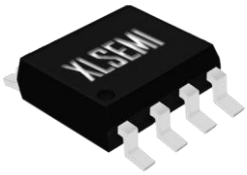


芯片

扫码登记参观

上海芯龙半导体技术股份有限公司　16D32 0.4A 150KHz 100V降压型DC-DC转换器

XL7005A是一款高效、高压降压型DC-DC转换器，固定150KHz开关频率，可提供最高0.4A输出电流能力，低纹波，出色的线性调整率与负载调整率。XL7005A内置固定频率振荡器与频率补偿电路，简化了电路设计。



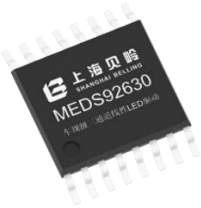
青岛本原微电子有限公司　16C71　DSP BY320RV0049

RISC-V内核版实时控制类DSP。采用中科本原自研的浮点DSP内核——SummerCore。SummerCore集成TMU、VCU、VCRC、FINTDIV等增强计算模块，同时配备一个独立的控制律加速器（CLA），采用CLA处理时间敏感事件，可以释放主核性能，使主核能并发处理其他系统与通信任务。
该处理器工作频率为150MHz，集成了加电和欠压复位功能、40个复用通用输入输出引脚、3个32位定时器、集成了I2C、SPI、ADC、LIN、PWM、eQEP、CAN-FD等接口。
应用于空调室外机、工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、光伏逆变器、工业电源和服务器电源等领域。



上海贝岭股份有限公司　16E03　MEDS92630

MEDS92630 是一款车规级3通道线性LED驱动器，具有模拟和PWM调光控制，40V输入耐压，由基准电阻器设定的可调恒定输出电流，每通道最大150mA，具有完善模拟和PWM调光功能、热管理和热关断功能、故障检测功能等线性LED驱动芯片。
其产品的独特优势：器件的全面故障检测和内置保护使其成为可达到中等功率范围的可变强度汽车LED照明应用的理想选择。可广泛应用于尾灯,日间行车灯、驻车灯、雾灯、位置灯、车内照明等领域。



苏州速显微电子科技有限公司　16C40　GPU显示芯片

GC90系列芯片已累计出货超500万片，最新获奖的“端侧大模型推理GPU芯片及软硬件生态”项目，凭借自研TH1100具身智能计算GPU芯片及TUCA开发者平台，在2026年人工智能场景创新应用大赛中从200余项目中斩获唯一一等奖。



*以上所有企业产品及展位号以现场位置为准。

同期超90场高峰论坛，中国国际光电高峰论坛一览表

会议时间	会议地点	会议名称
9/9上午	南登录大厅二楼红树林厅A	第27届中国国际光电博览会开幕式暨第11届 IEEE 全球光电大会主题报告
9/9下午	9号馆二楼9B	全球光电及半导体发展高峰论坛
国际量子技术科学前沿论坛		
会议时间	会议地点	会议名称
9/10全天	5号馆二楼5B	2026国际量子技术科学前沿论坛
信息通信产业发展论坛		
会议时间	会议地点	会议名称
9/9下午	9号馆二楼9A	AI时代高速光传输技术创新论坛
9/9下午	9号馆二楼9C	万兆光接入：AI+智能化升级与应用论坛
9/9下午	13号馆馆内会议室	光电产业高峰论坛--光电“芯”未来
9/9下午	14号馆二楼14B	2026中国MicroLED CPO产业链创新发展高峰论坛
9/9下午	10号馆二楼10ABC	芯·光论坛——面向未来的AI算力网络与高速光互连技术研讨会
9/10上午	1号馆二楼1C	400G per lane MSA及AIDC高速光/电互连研讨会
9/10下午	13号馆馆内会议室	ePIXfab中欧硅基光电子论坛
9/10下午	10号馆二楼10ABC	IPEC NPO峰会 — NPO：The Realistic Choice of AI Interconnected Ecosystem and Technology
9/10全天	9号馆二楼9B	AI算力集群光互连技术发展论坛
9/10全天	9号馆二楼9C	光电融合技术与产业发展论坛
9/11上午	9号馆二楼9C	AI+新型光纤应用论坛

同期超90场高峰论坛，中国国际光电高峰论坛一览表

全球精密光学技术及应用论坛		
会议时间	会议地点	会议名称
9/9下午	5号馆二楼5A	“AI+计算光学成像”新机遇论坛
9/9下午	5号馆二楼5B	光学半导体检测技术论坛
9/9下午	5号馆二楼5C	纳米压印制造技术论坛
9/9下午	1号馆二楼1A	眼科影像传感技术发展与应用论坛
9/9下午	3号馆馆内会议室	CIOE2026 精密光学“新品首发”专场发布会
9/9下午	7号馆馆内会议室	欧洲光电产业协会技术展望大会 - 光学产业链创新：材料、制造、计量、集成与系统
9/10上午	5号馆二楼5A	超构&微纳光学制造技术论坛
9/10下午	5号馆二楼5A	光学超精密加工制造论坛
9/10上午	3号馆馆内会议室	医疗内窥成像技术论坛
9/10下午	3号馆馆内会议室	手持智能影像设备技术发展论坛
9/10全天	7号馆馆内会议室	光学真空镀膜大会
9/11上午	7号馆馆内会议室	光电赋能低空经济新质生产力论坛

激光技术创新及应用论坛		
会议时间	会议地点	会议名称
9/9下午	2号馆二楼2C	激光微纳加工先进制造论坛
9/9下午	4号馆馆内会议室	激光焊接助力智能制造创新应用论坛
9/9下午	2号馆二楼2A	激光技术赋能半导体制造论坛
9/10全天	4号馆馆内会议室	激光技术赋能医疗发展论坛 （上午场：光电医疗 下午场：光电医美）
9/10下午	1号馆二楼1A	水导激光精密加工技术与应用论坛
9/10全天	2号馆二楼2A&2B	第二十届全国激光加工技术研讨会 (LPC2026)

红外产业洞察及应用论坛		
会议时间	会议地点	会议名称
9/10全天	6号馆二楼6C	红外探测技术及应用论坛
9/10全天	8号馆馆内会议室	工业4.0下的智能检测与预测性维护论坛 分会场一：石油应用专场 分会场二：化工应用专场
9/10下午	6号馆二楼6D	2026石油化工智慧安全运维闭门研讨会 （闭门，仅限邀请）

同期超90场高峰论坛，中国国际光电高峰论坛一览表

光+汽车		
会议时间	会议地点	会议名称
9/9下午	1号馆二楼1B	2026第五届车载摄像头前沿技术与测试方法研讨会
9/10全天	9号馆二楼9A	2026车载光通信技术创新应用论坛
9/10全天	5号馆二楼5C	第八届“光"+智能汽车技术高峰论坛

光+机器人		
会议时间	会议地点	会议名称
9/10上午	1号馆二楼1A	面向具身智能的智能光学技术论坛
9/10全天	6号馆二楼6A	视觉感知 · 智造未来 — 具身智能机器人融合应用论坛

光+显示		
会议时间	会议地点	会议名称
9/10全天	2号馆馆内会议室	微显示产业发展论坛

光+AR & VR		
会议时间	会议地点	会议名称
9/9下午	2号馆馆内会议室	全球空间计算产业发展论坛
9/9下午	2号馆二楼2B	AR/VR 光学技术应用高峰论坛
9/10全天	2号馆二楼2C	AI AR眼镜产业发展论坛
9/11上午	2号馆馆内会议室	大空间交互与沉浸体验技术高峰论坛

光+智能传感		
会议时间	会议地点	会议名称
9/9下午	6号馆二楼6B	2026智能传感与高端仪器创新发展论坛
9/10下午	南登录大厅一楼媒体中心A	2026 SEG第二届光纤传感技术研讨会
9/10全天	6号馆二楼6B	第41届“微言大义”研讨会：3D传感与成像技术及应用
9/11上午	1号馆二楼1C	先进光学与智能传感技术论坛

光+消费电子		
会议时间	会议地点	会议名称
9/9下午	6号馆二楼6A	2026智能家居发展趋势高峰论坛

光+安防		
会议时间	会议地点	会议名称
9/9下午	6号馆二楼6C	第四届AI安防与视觉技术创新发展论坛

光+天文		
会议时间	会议地点	会议名称
9/9上午	3号馆馆内会议室	星际视界 光影同行——2026中国光博会天文发展论坛

同期超90场高峰论坛，中国国际光电高峰论坛一览表

2026 CIOE&YOLE国际论坛

会议时间	会议地点	会议名称	购票价格
9/10上午	13号馆馆内会议室	AI浪潮下的光电技术：行业深度洞察	免费

学术会议：2026年中国光学学会学术大会（付费会议）

会议时间	会议地点	会议名称	购票价格
9/10-9/12	18号馆	2026年中国光学学会学术大会	购票价格（8月15 日前）： 普通代表-会员 1600、普通代表-非会员 2100、学生代表-会员 1000、学生代表-非会员 1200 购票价格（8月15 日后）： 普通代表-会员 2000、普通代表-非会员 2500、学生代表-会员 1200、学生代表-非会员 1400 听会注册网址： https://meeting.cncos.org.cn/cosconf2026/index.htm

学术会议：IEEE全球光电大会（OGC 2026）

会议时间	会议地点	会议名称		购票价格
9/8-9/11（9月8日注册报道，9月9日-11日会议）	南登录大厅西侧一楼会议区LM会议室	S1. 激光技术 S2. 光通信与网络 S3. 超材料与光子晶体 S4. 量子光学与信息 S5. 光纤技术及应用 S6. 光电器件及应用 S7. 生物光子学和生物医学光学 S8. 数据中心光互联与光网络 S9. 硅光子学 S10. 计算成像	特别会议： T1. 中红外激光器及其应用 T2. 海洋光子学 T3. 光电子EDA软件 T4. 先进光学光刻的新兴技术 T5. 光通信与传感技术 研讨会： W1. 光纤升级	IEEE Member:3500RMB Non-IEEE Member:3850RMB Student (IEEE Member) :2800RMB Student (Non-IEEE Member): 3150RMB
OGC学术会议投稿、听会注册网址：http://www.ipsogc.org/index.html				

IWAPS 国际先进光刻技术研讨会

会议时间	会议地点	会议名称	购票价格	
9/10-9/11	9月10日 南登录大厅二楼红树林厅A 9月11日 5号馆二楼5AB 6号馆二楼6AB 9号馆二楼9AB	IWAPS 国际先进光刻技术研讨会	8月25日前缴费 参会者-2800 学生-1600 中国光学学会光刻技术专业委员会会员-2400 赞助商超免费名额外参会者-2400 IWAPS委员会成员：免费	8月25日后缴费 参会者-3200 学生-1600 中国光学学会光刻技术专业委员会会员-2400 赞助商超免费名额外参会者-2400 IWAPS委员会成员：免费
听会注册网址： https://iwaps.org/cn/				

*具体会议以现场为准